POLITECHNIKI WROCLAWSHIUJ Raport Serii PRE 426/85

## ZJAWISKA TRANSPORTU PRĄDU PRZEZ ZŁĄCZA p-n Cd Hg To

Ewa Popko

Praca doktorska wykonana w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Promotor:

doc.dr hab.J.M. Pawlikowski

Instytut Fizyki

Politechniki Wrocławskiej

Serdecznie dziękuję mojemu promotorowi doc.dr hab.J.M.Pawlikowskiemu za okazaną życzliwość i opiekę.

Dziękuję dr P.Becli za wykonanie złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te które były przedmiotem badań w mojej pracy.

Dziękuję bardzo dr K.Sierańskiemu i dr J.Szatkowskiemu za owocne dyskusje i pomoc okazaną podczas realizacji mojej pracy.

Dziękuję również moim koleżankom i kolegom z Zakładu Fizyki Półprzewodników za pomoc i życzliwość

Ewa Popko

## SPIS TREŚCI

1.	WSTEP	str.4
2.	PODSTAWOWE WLASNOŚCI FIZYCZNE Cd Hg Te	. 6
3.	ELEKTRYCZNE I FOTOELEKTRYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZA p-n	12
	3.1. Prąd calkowity złącza p-n	12
	3.2. Prąd foto-generacji	13
	3.3. Prąd dyfuzyjny w zlączu p-n	15
	3.4. Prąd generacji-rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego złącza p-n	23
	3.5. Powierzchniowy prąd upływowy	27
	3.6. Prąd tunelowy w złączu p-n	28
	3.7. Pojemność złącza p-n	42
4.	CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA	46
	4.1. Wykonanie złączy p-n w Cd Hg Te	46
	4.2. Układy pomiarowe	48
,	4.3. Wyniki pomiarów	53
	4.4. Analiza wyników eksperymentalnych	87
5.	PODSUMOWANIE	106
6.	LITERATURA	110

## 1. NSTEP

Przez kilkanaście ostatnich lat prowadzono na całym świecie intensywne badania nad półprzewodnikowym związkiem mieszanym Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te. Detektory fotowoltaiczne wykonane na bazie monokryształów tego związku a także na bazie warstw epitaksjalnych Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te znalązły szerokie zastosowanie jako detektory promieniowania podczerwonego, czułe na zakres długości fali od około 0,8 µm do 30 µm.

4

Badania detektorów ze złączem p=n sugerowały, że dla detektorów wykonanych z  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{1-\mathbf{x}}$  Te dla których krawędź efektu fotowoltaicznego znajduje się w obszarze dalszej podczerwieni ( $\lambda_{c0} > 6 \mu$ m), prąd tunelowy płynący przez nieoświetlone złącze może być istotnym mechanizmem ograniczającym jego własności użytkowe.

Podstawowym parametrem określającym te własności jest tzw. detekcyjność detektora, która jest tym większa im niższa jest wartość prądu płynącego przez nieoświetlone złącze p=n.

Niniejsza praca stanowi kontynuację badań nad technologią otrzymywania warstw epitaksjalnych  $Cd_{x}Hg_{1-x}Te$  i złączy p-n wykonanych na bazie tych warstw, rozpoczętych kilkanaście lat temu w Zakładzie Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej [1-3]. W niniejszej pracy badano złącza p-n wykonane na bazie warstw epitaksjalnych  $Cd_{x}Hg_{1-x}Te$ , dla których krawędź efektu fotowoltaicznego mieściła się w zakresie od około 1 µm do kilkunastu µm. Celem pracy było wykazanie na ile istotny jest wkład prądu tunelowego do całkowitego prądu ciemnego w tych złączach. Przeprowadzono także próby dopasowania charakterystyk oporności różniczkowej w funkcji temperatury dla różnych mechanizmów tunelowania.

Rezultaty badań zostały opublikowane w [4 - 12] .

2. PODSTAWOWE WLAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Cd Hg - To

 $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1=x}$  Te jest substytucyjnym stopem półprzewodnikowym (kryształem mieszanym typu  $\operatorname{A}_{x}\operatorname{B}_{1=x}$ ) na bazie tellurku kadmu i tellurku rtęci.

Opis stanów elektronowych w półprzewodnikach mieszanych typu  $A_x B_{1-x}$  najczęściej opiera się na tzw. przybliżeniu kryształu wirtualnego [13]. Z powodu bardziej lub mniej chaotycznego rozkładu atomów poszczególnych składników stopu w sieci krystalicznej, rzeczywisty potencjał krystaliczny nie jest translacyjnie niezmienniczy. Przybliżenie kryształu wirtualnego polega na zamianie rzeczywistego potencjału na odpowiednio wybrany potencjał, który jest pewnym uśrednionym potencjalem kryształu i ma symetrię translacyjną. To przybliżenie jest możliwe jedynie w przypadku gdy składniki stopu mają identyczne, bądź mało różniące się stałe sieciowe. W modelu tym potencjał kryształu wirtualnego  $V_{VC}$  jest konstruowany jako średni potencjał ważony atomów składowych z koncentracjami molowymi poszczególnych składników jako wagą:

$$V_{VC}(\overline{r}) = (1 - x) \sum_{\overline{R}} V_{A}(\overline{r} - \overline{R}_{n}) + x \sum_{\overline{R}} V_{B}(\overline{r} - \overline{R}_{n})$$
(1)

gdzie x jest składem molowym, a  $V_A(\bar{r})$  i  $V_B(\bar{r})$  są potencjałami atomów, odpowiednio, składnika A i B.

Przywrócenie symetrii translacyjnej potencjałowi krystalicznemu a więc i jednoelektronowemu hamiltonianowi stopu , pozwala na zastosowanie standardowych metod ciała stałego do opisu struktury pasmowej i elektronowych funkcji falowych.

- 6 --

Kryształy mieszane  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{1-\mathbf{x}}\operatorname{Te}$ , tak jak i obą materiały wyjściowe, mają strukturę blendy cynkowej. Ich własności fizyczne (np. szerokość przerwy energetycznej  $\operatorname{E}_0$ , masa efektywna nośników) zmieniają się przy zmianie składu, co jest m.in. źródłem ich ciekawych właściwości [14]. Dla małych składów molowych ( $\mathbf{x} < 0.165$  w T = 4,2 K), Cd\_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}\_{1-\mathbf{x}}Te ma tzw. ujemną przerwę energetyczną tzn. charakteryzuje się odwróconą strukturą energetyczną typu szarej cyny, przechodzącą w strukturę prostą typu InSb przy zwiększonej zawartości molowej kadmu (patrz rys.1). Ze względu na to, że odległości między pasmami energetycznymi  $\lceil_6$ ,  $\lceil_8$  i  $\lceil_7$  w dużym zakresie x są małe w porównaniu z odległością tych pasm od po-



Rys.1. Struktura pasmowa Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te w pobliżu punktu strefy Brillouina: a) struktura odwrócona typu szarej cyny, b) przejście od struktury odwróconej do prostej, c) struktura prosta typu InSb. ---- 8 ----

zostałych pasm, możliwym jest stosowanie opisu Kane'a [15,16] zastosowanym pierwotnie do opisu struktury energetycznej InSb a następnie do grupy związków III-V i II-VI. W modelu tym dla struktury prostej, dwukrotnie zdegenerowane pasmo przewodnictwa o symetrii  $\lceil_6$  jest nieparaboliczne. Odległe od niego o szerokość przerwy energetycznej  $\mathbf{E}_0$  pasmo walencyjne  $\lceil_8$  jest czterokrotnie zdegenerowane w punkcie  $\lceil$ . Poża punktem  $\lceil$  jest ono rozszczepione na dwukrotnie zdegenerowane nieparaboliczne pasmo dziur lekkich (o krzywiźnie takiej jaką ma pasmo  $\lceil_6$ ) i dwukrotnie zdegenerowane pasmo dziur ciężkich. W odległości  $\triangle$  poniżej  $\lceil_8$  leży dwukrotnie zdegenerowane pasmo  $\lceil_7$  odszczepione na skutek oddziaływania spin-orbita.

Dla pasma przewodnictwa, zależność energii elektronu  $E_{C}^{\prime}(\overline{k})$  od wektora falowego  $\overline{k}$  ma postać:

 $E_{C}'(k) = -\frac{E_{0}}{2} + \frac{E_{0}}{2} \left[1 + \frac{\hbar^{2} k^{2}}{2m_{e}^{*}}\right]^{\frac{1}{2}}$ (2)

gdzie

$$m_{e}^{*} = \frac{3\hbar^{2} E_{0}}{4P^{2}} \frac{\Delta + E_{0}}{\Delta + \frac{3}{2} E_{0}}$$
(3)

i  $m_e^{\star}$  jest masą efektywną elektronu na dnie pasma przewodnictwa, P - elementem macierzowym operatora pędu, a  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ i h jest stałą Plancka.

W przybliżeniu kryształu wirtualnego, przerwa energetyczna E zmienia się liniowo ze składem. Jednakże dla Cd Hg Te obserwowana eksperymentalnie zależność  $E_0(x)$  odbiega od zależności liniowej [17-19]. Rozbieżności te możną tłumaczyć istnieniem składowej nieperiodycznej potencjału, związanej z nieuporządkowaniem chemicznym stopu i zaburzeniem związanym z istnieniem różnie w wartościach stałych sieci HgTe i CdTe (nieporządek geometryczny) [20]. Fenomenologiczny opis zależności  $E_0(x,T)$  przedstawiono w pracach [17-19]. W niniejszej pracy korzystano ze wzoru Schmita i Stelzera [18], opisującego zależność  $E_0(x,T)$  dla 0,13  $\leq x \leq 0,6$  w postaci:  $E_0(x,T) = -0,25 + 1,59 \cdot x + 5,233 \cdot 10^{-4}$  (1 - 2,08 · x) · T + 0,327 x<sup>3</sup> [eV]

(4)

Zależność koncentracji samoistnej od składu i temperatury badano w pracach [21,22], uwzględniając nieparaboliczność pasma przewodnictwa. W pracy [21] wyznaczono koncentrację samoistną  $n_i(x,T)$  w zakresie  $0 \le x \le 0,3$  metodą numeryczną. Natomiast w pracy [22] wyznaczono koncentrację samoistną  $n_i(x,T)$  dla składów 0,16 < x <0,8 i wyniki przedstawiono w postaci:

$$n_{i}(\mathbf{x}, \mathbf{T}) = (9,908 - 5,21 \cdot \mathbf{x} + 3,08 \cdot \mathbf{T} \cdot 10^{-4} + 5,94 \cdot 10^{-3} \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{x}) \cdot \frac{3/4}{10^{-3} \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{x}} - \frac{E_{0}}{2kT} [m^{-3}]$$
(5)

gdzie k jest stałą Boltzmanna.

W Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te głównym mechanizmem rozpraszania nośników w niskich temperaturach jest rozpraszanie na zjonizowanych domieszkach. W wyższych temperaturach rozpraszanie jest limitowane polarnym oddziaływaniem z podłużnymi fononami optycznymi. W  $Cd_xHg_{1-x}Te$  stwierdzono występowanie dwóch modów fononowych, z których jeden jest modem pochodzącym od HgTe a drugi od CdTe. Siły oscylatorów i energie obydwu modów zmieniają się ze składem. Wyniki eksperymentalne, prezentujące zależność energii fononów optycznych od składu x w T = 77 K i 300 K zebrano w pracy [23]. Przykładowo, w T = 77 K, energia modu pochodzącego od HgTe zmienia się od wartości 15,9 meV dla HgTe do 17,2 meV dla  $Cd_{0,4}Hg_{0,6}Te, zaś$ energia modu związanego z CdTe zmienia się odpowiednio od 18,4 meV do 19 meV.

Dla  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{1-\mathbf{x}}$  Te typu p, o otwartej przerwie energetycznej stwierdzono istnienie poziomów akceptorowych o energiach  $\operatorname{E}_{\mathbf{A}}$  około kilkanaście meV powyżej wierzchołka pasma walencyjnego. W [24] podano wartość  $\operatorname{E}_{\mathbf{A}} = 20 \text{ meV}$  dla  $\operatorname{Cd}_{0,3}\operatorname{Hg}_{0,7}$ Te typu p z koncentracją akceptorów  $\operatorname{N}_{\mathbf{A}} = 3 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ . W [25] dla  $\operatorname{Cd}_{0,4}\operatorname{Hg}_{0,6}$ Te typu p znaleziono poziom akceptorowy o energii  $\operatorname{E}_{\mathbf{A}} = 14 \text{ meV}$  przy koncentracji  $\operatorname{N}_{\mathbf{A}} = 3 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$ . Stwierdzono, że energia aktywacji poziomu akceptorowego maleje ze wzrostem koncentracji akceptorów i tak, dla  $\operatorname{N}_{\mathbf{A}} - \operatorname{N}_{\mathbf{D}} =$  $= 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ , energia ta maleje do wartości  $\operatorname{E}_{\mathbf{A}} = 3 - 4 \text{ meV}$ . Dla  $\operatorname{Cd}_{0,2}\operatorname{Hg}_{0,8}$ Te typu p zaobserwowano poziom akceptorowy o energii  $\operatorname{E}_{\mathbf{A}} = 15 \text{ meV}$  [26]. Położenie tych poziomów akceptorowych wiąże się z istnieniem pojedyńczo zjonizowanych luk rtęciowych.

W pracy [26] zaobserwowano dla  $Cd_{0,2}Hg_{0,8}Te$  typu p centra pułapkowe o energii  $E_t = 60$  meV powyżej wierzchołka pasma walencyjnego. W [27] zaobserwowano w  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{\mathbf{1}=\mathbf{x}}^{\operatorname{Te}}$ typu p, dla 0,2 <x <0,4, centra pułapkowe połcżone w pobliżu środka przerwy energetycznej. Istnienie centrów pułapkowych przypisano w obydwu wypadkach podwójnie zjonizowanym lukom po rtęci.

W pracy [28] stwierdzono, że luki po tellurze są odpowiedzialne za powstanie  $Cd_{x}Hg_{1-x}$  Te typu n. Natomiast W [29,30] pokazano, że można otrzymać warstwy epitaksjalne Cd\_Hg\_\_\_Te, "as-grown" (metodą IVPE) typu p lub n, kontrolując ciśnienie par rtęci. Pozwoliło to na wysnucie wniosku, że w Cd\_Hg1\_Te istnieją defekty naturalne (np. tellur w położeniu kationowym) działające jak domieszka domorowa. Jeśli luk rtęciowych odpowiedzialnych za ilość akceptorów jest dużo więcej niż tych defektów, wówczas otrzymuje się materiał typu p. W przeciwnym wypadku, otrzymuje się materiał typu n. Istnienie defektów naturalnych tłumaczy również dobrze zmianę typu przewodnictwa Cd\_Hg1\_Te z typu p na typ n poprzez wygrzewanie materiału typu p w parach rtęci. Jednakże definitywne rozstrzygnięcie, jakie defekty dzialają jako donory w Cd\_Hg<sub>1\_r</sub>Te wymaga dalszych badań.

3. ELEKTRYCZNE I FOTOELEKTRYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZA p-n
 3.1. Prąd całkowity w złączu p-n

Nieoświetlone złącze p-n z dyfuzyjną barierą potencjału ma charakterystykę prądowo napięciową w postaci

$$I_{D} = I_{0} \left[ \exp \frac{e(U - IR_{s})}{nkT} - 1 \right] + \frac{U - IR_{s}}{R_{p}}$$
(6)

gdzie  $I_D$  oznacza całkowity prąd nieoświetlonego złącza pod napięciem U;  $R_s i R_p$  to, odpowiednio, szeregowa i równoległa (upływu) oporność złącza; n to tzw. czynnik diodowy,  $I_0$  oznacza prąd nasycenia w kierunku zaporowym.

Oświetlenie złącza strumieniem fotonów o energii  $\hbar\omega \ge E_0$ , powoduje generację par swobodnych nośników (elektron-dziura), które są separowane w obszarze ładunku przestrzennego złącza. Wynikiem tej separacji jest powstanie siły elektromotorycznej (V<sub>OC</sub>, tj. napięcia obwodu rozwartego). W przypadku zwarcia złącza, płynie wygenerowany fotonami prąd zwarcia I<sub>SC</sub>. Całkowity prąd I\_ płynący przez oświetlone złącze p-n jest równy

$$I_{c} = I_{D} - I_{SC}^{\prime}$$
(7)

gdzie prąd "ciemny" $I_D$  dany jest wzorem(6) a  $I_{SC}$  oznacza prąd wygenerowany światłem. Składnikami prądu ciemnego  $I_D$  są: prąd dyfuzyjny  $I_d$ , prąd generacji-rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego  $I_{g-r}$ , prąd tunelowy  $I_t$ , powierzchniowy prąd upływowy  $I_s$  oraz prąd generowany promieniowaniem tła Ig. Zatem

$$I_{D} = I_{d} + I_{g-r} + I_{t} + I_{s} - I_{\phi_{b}}$$

$$(8)$$

Poniżej omówione zostaną poszczególne składniki prądu w złączu p-n.

3.2. Prąd fotogeneracji

Załóżmy, że prostopadle do złącza p-n , na jednostkę powierzchni złącza w jednostce czasu pada  $\emptyset$  fotonów o energii od h  $\frac{C}{\lambda_1}$  do h  $\frac{C}{\lambda_2}$  i generuje nośniki z całkowitą wydajnością kwantową OCE( $\lambda$ ), będącą iloczynem wydajności wychwytu fotonów, kwantowej (generacji) i kolekcji nośników. Wówczas gęstość prądu generowanego fotoprądu J wyraża się następującym wzorem:

$$J_{sc} = e \int OCE(\lambda) \mathcal{D}(\lambda) d\lambda$$
(9)

i J liniowo zależy od ilości wygenerowanych nośników, które dotarły do kontaktów.

Można pokazać, że

$$V_{\rm OC} \sim \ln\left(\frac{J_{\rm sc}}{J_{\rm O}} + 1\right)$$

(10)

zatem napięciowa odpowiedź detektora jest logarytmiczną funkcją ilości nośników.

Parametrami użytkowymi detektora są (oprócz  $V_{OC}$  i  $J_{sc}$ ): ekwiwalentna moc szumów NEP $_{\lambda}$ , detekcyjność znormalizowana  $D_{\lambda}^{\star}$  i  $\lambda_{c_0}$ , czyli graniczna długość fali promieniowania elektromagnetycznego dla zjawiska fotowoltaicznego. Znając wartość  $\lambda_{c_0}$ , można określić wartość  $E_0$ :

$$\mathbf{E}_{0} = \frac{\mathbf{hC}}{\lambda_{c_{0}}} \cong \frac{\mathbf{1,24}}{\lambda_{C_{0}}} \quad [eV]$$
(11)

Jeśli zdefiniuje się stosunek sygnału S prądowego wywołanego światłem do szumu N według następującej zależności:

$$S/N = \frac{I_{sc}}{\sqrt{I_n^2}}$$
(12)

gdzie  $I_{sc}$  jest natężeniem fotoprądu , którego gęstość jest określona wzorem (9) zaś  $\overline{I_n^2}$  jest wartością średnią z kwadratu prądu szumów, wówczas ekwiwalentna moc szumów NEP<sub> $\lambda$ </sub> wyraża się następującym wzorem

$$NEP_{\lambda} = \frac{P_{\lambda}}{S/N \sqrt{\Delta f}} \left[ W/\sqrt{H_{z}} \right]$$
(13)

gdzie  $P_{\lambda}$  jest mocą padającego promieniowania i jest iloczynem energii fotonów h  $\frac{c}{\lambda}$ , liczby padających fotonów w jednostce czasu na jednostkę powierzchni  $\emptyset$  i powierzchni światłoczułej złącza A; natomiast  $\Delta$  f jest szerokością pasma przenoszenia przedwzmacniacza.

Detekcyjność znormalizowaną  $D_{\lambda}^{\star}$  definiuje się następująco:

$$D_{\lambda}^{*} = \frac{\sqrt{A}}{NEP_{\lambda}} = \frac{\sqrt{A} I_{sc}}{P_{\lambda} \sqrt{I_{n}^{2}}} \quad \forall f \left[ cm Hz / W \right] \quad (14)$$

W przypadku zerowej polaryzacji złącza p-n szumami ograniczającymi detekcyjność są szumy termiczne Johnsona-\_Nyquista. Wówczas  $D_{\lambda}^{\times}$  wyraża się następującym wzorem [31]

$$D_{\lambda}^{*} = \frac{e \cdot OCE(\lambda)}{h \cdot C} \left(\frac{R_{0}A}{kT}\right)$$
(15)

gdzie

$$R_0 \equiv \left(\begin{array}{c} \frac{dI}{dU} \right)^{-1} \\ U = 0 \end{array}$$
(16)

jest opornością różniczkową złącza przy zerowej polaryzacji. Jak wynika z (15) oporność R<sub>0</sub> pomnożona przez powierzchnię złącza A, jest bardzo ważnym parametrem gdyż determinuje wielkość  $D^*_{\lambda}$ . Wartość R<sub>0</sub>A jest określona przez ten z prądów, który daje największy wkład do całkowitego prądu ciemnego I<sub>D</sub>, określonego wzorem (8).

## 3.3. Prąd dyfuzyjny w zlączu p-n

Prąd dyfuzyjny jest głównym mechanizmem warunkującym transport nośników przez złącze p-n w wysokich temperaturach (w pobliżu 300 K). Powstaje on w wyniku termicznej generacji (i rekombinacji) par elektron-dziura, w pobliżu obszaru ładunku przestrzennego (w odległości nie większej niż długość drogi dyfuzji nośników mniejszościowych).

Na rys.2 przedstawiono schematycznie przekrój przez złącze p-n



Przekrój przez złącze p-n . Zaznaczono: kwasineutralny Rys.2. obszar typu n (-a - W < z <-W), obszar ładunku przestrzennego (-W < z < 0) i kwasineutralny obszar typu p( 0 < z < d).

Załóżmy że: 1) całe napięcie polaryzujące zlącze p-n przypada na obszar ładunku przestrzennego o grubości W ; 2) koncentracje nośników mniejszościowych generowanych termicznie, są małe w porównaniu do ich koncentracji równowagowych; 3) żadna ze stron złącza p-n nie jest zdegenerowana; 4) krawędzie obu stron złącza znajdują się w odległości dużo większej od długości drogi dyfuzji nośników mniejszościowych. Korzystając wówczas z warunku neutralności dla obydwu obszarów złącza poza obszarem ladunku przestrzennego i z równania ciągłości, otrzymuje się 31 | następujące zależności na gęstości prądów dyfuzyjnych nośników mniejszościowych z obszaru typu p i n, odpowiednio Jp∞ i J

$$J_{n_{\infty}} = e_{n_{0}} \cdot \frac{D_{p}}{L_{p}} \left[ e_{xp} \left( \frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$
(17a)  
$$J_{p_{\infty}} = e_{p_{0}} \cdot \frac{D_{n}}{L_{p}} \left[ e_{xp} \left( \frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$
(17b)

i p<sub>no</sub> są koncentracjami równowagowymi, D<sub>n</sub> i D<sub>p</sub> gdzie npo współczynnikami dyfuzji,  $L_n$  i  $L_p$  długościami drogi dyfuzji nośników mniejszościowych w obszarach typu p i n odpowiednio. Całkowita gęstość prądu dyfuzyjnego  $J_d$  , jest sumą obydwu składowych  $J_{p_{\infty}}$  i  $J_{n_{\infty}}$ :

[p<sub>∞</sub>

$$J_{d} = J_{0} \exp\left[\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1\right]$$
(18)

gdzie

$$J_{0} \equiv \frac{e D_{p} P_{n0}}{L_{p}} + \frac{e D_{n} P_{p0}}{L_{n}}$$
(19)

Jak wynika z równania (18), dla napięcia polaryzującego złącze w kierunku przewodzenia w stałej temperaturze T, charakterystyka ln  $J_d = f(U)$  jest linią prostą o współczynniku nachylenia równym e/kT. Dla polaryzącji zaporowej  $J_d = J_0$  i z charakterystyki prądowo-napięciowej można określić  $J_0$ . Znając  $J_0$ , można określić jeden z parametrów wchodzących w skład  $J_0$  we wzorze (19) znając pozostałe parametry.

Obliczone na podstawie wzorów (16) i (17a,b) parametry  $R_0^A$  wynoszą odpowiednio:

$$(R_0 A)_{n_{\infty}} = \frac{kT}{e^2} \cdot \frac{N_D}{n_i^2} \cdot \frac{\tau_p}{L_p}$$
(20a)

i

$$(R_0^A)_{p_{\infty}} = \frac{kT}{e^2} \cdot \frac{NA}{n_1^2} \cdot \frac{\tilde{l}_n}{L_n}$$
(20b)

przy czym skorzystano ze wzoru:

$$L_{n(p)} = \sqrt{D_{n(p)} \cdot T_{n(p)}}$$
(21)

We wzorach (20) i (21)  $\tau_{n(p)}$  jest czasem życia nośników mniejszościowych. Założono także iż równowagowa koncentracja dziur p<sub>p0</sub> jest równa koncentracji akceptorów N<sub>A</sub> zaś równowagowa koncentracja elektronów n<sub>n0</sub> jest równa koncentracji donorów N<sub>D</sub>.

Jeśli długości obszarów typu p i n są mniejsze od długości drogi dyfuzji nośników mniejszościowych, wówczas słuszne są następujące zależności [32]:

$$(R_0A)_n = \frac{kT}{e^2} \cdot \frac{N_D}{n_i^2} \cdot \frac{\gamma_p}{a}$$
(22a)

$$(R_0A)_p = \frac{kT}{e^2} \cdot \frac{N_A}{n_i^2} \cdot \frac{\tilde{\tau}_n}{d}$$
(22b)

gdzie d i a to grubości kwasineutralnych obszarów typu p i n, odpowiednio. Powyższe wzory są słuszne przy założeniu, że szybkość rekombinacji powierzchniowej jest dużo mniejsza od szybkości dyfuzji  $L_{n(p)} / \tau_{n(p)}$ .

Z porównania wzorów (20b) i (22b) wynika, że zmniejszenie grubości obszaru typu p do wartości mniejszej niż  $L_n$ zwiększa wartość  $R_0A$  o czynnik  $L_n/d$ .

Całkowity parametr R<sub>O</sub>A jest wypadkową parametrów dla obydwu obszarów

$$\frac{1}{R_0 A} = \frac{1}{(R_0 A)_n} + \frac{1}{(R_0 A)_p}$$
(23)

Aby porównać wkład  $(R_0^A)_n$  i  $(R_0^A)_p$  do  $R_0^A$ , obliczmy ich stosunek. Ze wzorów (22a) i (22b) mamy:

$$\frac{(R_0^A)_n}{(R_0^A)_p} = \frac{N_D}{N_A} \cdot \frac{\tau_p}{\tau_n} \cdot \frac{d}{a}$$
(24)

Jeśli ten stosunek jest dużo większy od jedności, wówczas  $(R_0A)_p$  determinuje całkowitą wartość parametru  $R_0A$ ,

Dla złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{1-\mathbf{x}}$  Te badanych w niniejszej pracy d jest dużo większe od a i jeśli  $\mathcal{T}_{\mathbf{p}} = \mathcal{T}_{\mathbf{n}}$  i N<sub>D</sub> niewiele różni się od N<sub>A</sub>, to ten stosunek jest rzeczywiście dużo większy od jedności.

Ze względu na dużą różnicę w masach efektywnych elektronów w pasmie przewodnictwa i dziur ciężkich w pasmie walencyjnym, obszar typu p zlączy p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$ Te jest zwykle niezdegenerowany (przy najwyższym  $N_{A} = 1 \div 3 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ możliwym do otrzymanią w materiałe typu p) natomiast obszar typu n staje się zdegenerowany dla stosunkowo niskiej koncentracji elektronów (np. rzędu  $10^{21} \text{ m}^{-3}$  dla x = 0,2). W badanych złączach obszar typu p jest dużo większy od obszaru typu n, dlatego też prąd nośników mniejszościowych z obszaru p determinować będzie całkowity parametr  $R_0A$ . Ponieważ ten obszar w badanych złączach nie jest niezdegenerowany, parametr  $(R_0A)_p$  jest nadal określony wzorem (22b). Jeśli czas życia nośników mniejszościowych nie zależy od temperatury, wówczas zgodnie z (22b), parametr ten zmienia się w funkcji temperatury jak  $n_i^{-2}$ .

Wracając do wzoru (22b) widać, że obliczenie dokładnej wartości  $(R_0A)_p$  wymaga znajomości czasu życia nośników mniejszościowych  $\tau_n$ . W pracy [33] badano czas życia nośników mniejszościowych w fotodiodach p-n<sup>+</sup> Cd\_rHg<sub>1-r</sub>Te dla 9,2 < x < 0,4 i stwierdzono, że czas życia był limitowany rekombinacją typu Shockley'a-Read'a z udziałem centrów pułapkowych [34]. Rekombinację typu Shockley'a-Read'a przedstawiono schematycznie na rys.3.



Rys.3. Schemat rekombinacji typu Shockley-Read z udziałem centrów pułapkowych E<sub>t</sub>, położonych w pobliżu środka przerwy energetycznej E<sub>0</sub>. Rys.5a): elektron spada na poziom pułapkowy; 5b) rekombinuje z dziurą w wyniku czego uzyskuje się stan końcowy przedstawiony na rys.5c), Strzałki oznaczają przejścia elektronów (zaciemnione kółko).

Jeśli zmiana koncentracji nośników mniejszościowych wywołana rekombinacją jest dużo mniejsza od równowagowej koncentracji nośników większościowych (w tym wypadku  $p_{p0}$ ) zaś poziom energetyczny pułapek  $E_t$  leży nieco poniżej  $E_0$  /2, wówczas czas życia związany z rekombinacją typu Shockley'a -Read'a wyraża się [34] następującym wzorem:

$$\mathcal{T}_{S-R} = \mathcal{T}_{n_0} \left[ 1 + \frac{E_{Fp} - E_t}{kT} \right]$$
(25)

gdzie E<sub>Fp</sub> jest odległością poziomu Fermiego po stronie p złącza od wierzchołka pasma walencyjnego i T<sub>no</sub> wyraża się zależnością:

$$\tau_{n_0} = (6_n v_{th_n} N_t)^{-1}$$
 (26)

We wzorze (26)  $G_n$  jest przekrojem czynnym na pulapkowanie elektronów a  $V_{th_n} = (8 \text{ kT} / \pi \text{ m}_e^*)$  jest prędkością termiczną elektronów, zaś  $N_t$  jest koncentracją centrów pułapkowych.

W temperaturach T < 77 K można przyjąć  $\mathcal{T}_{S=R} = \mathcal{T}_{n_0}$ . W wyższych temperaturach należy obliczać  $\mathcal{T}_{S=R}$  ze wzoru (25). Jeśli teraz wrócić do wzoru (22b), to widać że dla  $\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_{S=R}$  z (25),  $(R_0A)_p$  rośnie ze zmniejszaniem się temperatury wolniej niż  $n_i^{-2}$ .

Z pracy Casselmana i Petersena [35] wynika, że w  $Cd_xHg_{1-x}Te$  typu p , dla 0,16 < x < 0,3 w zakresie temperatur 50 K < T < 300 K dominującym mechanizmem limitującym czas życia nośników jest jeden z możliwych wariantów efektu Auger'a , w którym elektron rekombinując z ciężką dziurą oddaje energię elektronowi z pasma dziur lekkich, wzbudzając go do pustych stanów w pasmie dziur ciężkich. Schematycznie sytuację tą przedstawia rys.4.

W takim procesie rekombinacji, czas życia nośników mniejszościowych będzie równy czasowi życia nośników większościowych (w tym wypadku dziur). Ponieważ czas życia limitowany procesem Auger'a dla koncentracji niesamoistnej jest proporcjonalny do  $p_{p_0}^{-2}$ , to ze wzoru (22b) wynika, że



Rys.4. Stan początkowy (4a) i końcowy (4b) dla procesu rekombinacji Auger'a w Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te typu p.

 $(R_0A)_p$  powinno zmieniać się jak  $n_i^{-2}$  ze zmianą temperatury.

Podsumowując, dla złączy p-n w  $Cd_{x}Hg_{1-x}Te$  w których nie ma centrów pułapkowych, parametr  $(R_{0}A)p$  związany z prądem dyfuzyjnym zmienia się z temperaturą jak  $n_{i}^{-2}$ , zaś dla złączy w których istnieją takie centra ,  $(R_{0}A)_{p}$  rośnie wolniej niż  $n_{i}^{-2}$  ze zmniejszaniem się temperatury.

• 22 **-**

3.4. Prąd generacji-rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego złącza p-n

Domieszki lub defekty zlokalizowane w obszarze ładunku przestrzennego, mogą działać jako centra generacji-rekombinacji typu Shockley'a - Read'a , a więc powodować przepływ prądu przez złącze p-n , szczególnie w niższych temperaturach, w których prąd dyfuzyjny jest bardzo mały. W stanie stacjonarnym, szybkość rekombinacji przez te centra, zlokalizowane na poziomie  $E_t$  powyżej wierzchołka pasma walencyjnego, wyraża się [34] zależnością:

$$u(z) = \frac{n(z) \cdot p(z) - n_i^2}{\widetilde{\tau}_{p_0} \left[ n(z) + n_1 \right] + \widetilde{\tau}_{n_0} \left[ p(z) + p_1 \right]}$$
(27)

gdzie n(z) i p(z) są nierównowagowymi koncentracjami elektronów i dziur w obszarze ładunku przestrzennego.  $n_1$  i  $p_1$  są opisane następującymi wzorami:

$$n_1 = N_c \exp(\frac{E_t - E_0}{kT})$$
 (28a)

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{N}_{\mathbf{v}} \exp\left(-\frac{-\mathbf{E}_t}{\mathbf{kT}}\right)$$
(28b)

gdzie N i N to efektywna gęstość stanów w pasmie przewodc v nictwa i walencyjnym, odpowiednio.

Występujące we wzorze (27)  $\tilde{\tau}_{p_0}$  wyraża się wzorem analogicznym do  $\tilde{\tau}_{n_0}$ :

$$\tau_{p_0} = (6_p V_{thp} N_t)^{-1}$$
 (29)

Jeśli teraz przyjmie się takie same założenia jak na początku rozdziału 3.3., wówczas centra g-r powodują rekombinację dla napięcia polaryzującego złącze p-n w kierunku przewodzenia (U > 0) i generację dla napięcia polaryzującego złącze w kierunku zaporowym (U < 0).

Gęstość prądu generacji-rekombinacji otrzymuje się po scałkowaniu równania (27) po szerokości obszaru ładunku przestrzennego:

$$J_{g=r} = e \int_{W} u(z) dz$$
(30)

Podstawiając wzór (27) do (30) i zakładając że potencjał zmienia się liniowo w obszarze ładunku przestrzennego, otrzymano w [36] następujące wyrażenie na gęstość prądu generacji--rekombinacji:

$$J_{g-r} = \frac{en_{i} W}{\sqrt{\frac{\gamma_{n_{o}} \gamma_{Po}}{r_{o} r_{Po}}}} \cdot \frac{\sinh (-eU/2 kT)}{e(U_{bi} - U)/2 kT} \cdot f(b) \quad (31)$$

gdzie U<sub>bi</sub> jest potencjałem dyfuzyjnym w złączu p-n, takim, że e-U<sub>bi</sub> jest różnicą energii krawędzi pasm przewodwodnictwa (walencyjnego) po stronie n i p złącza p-n przy zerowej polaryzacji.

Równanie (31) jest słuszne dla napięć polaryzujących mniejszych od  $U_{bi}$  o kilka kT/e. Funkcja f(b) jest w przybliżeniu równa:

$$f(b) = \int_{0}^{\infty} \frac{dy}{y^{2} + 2by + 1}$$
(32)

gdzie

$$b = \exp\left(-\frac{eU}{2kT}\right) \cos h \left[\frac{E_t - E_i}{kT} + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\gamma_{p_0}}{\gamma_{n_0}}\right)\right] \quad (33)$$

a E jest położeniem poziomu Fermiego w półprzewodniku samoistnym. Obliczając parametr (R<sub>0</sub>A)<sub>g-r</sub> związany z prądem generacji-rekombinacji opisanym wzorem (31) otrzymuje się:

$$(R_0A)_{g=r} = \frac{\sqrt{\tau_{n_0} \cdot \tau_{p_0}}}{en_i \cdot W \cdot f(b)} \cdot U_{bi}$$
(34)

Dla najbardziej efektywnych centrów g-r, szybkość rekombinacji u(z) ma maksymalną wartość. Jest to spełnione, gdy  $E_t = E_i$  oraz  $\mathcal{T}_{n_0} = \mathcal{T}_{p_0}$ . Wówczas dla U = 0 mamy b = 1 i f(1) = 1. Ponieważ  $\mathcal{T}_{n_0}$  nie zależy od temperatury, to  $(R_0A)_{g-r}$ zmienia się w funkcji temperatury jak  $n_i^{-1}$ . Jeśli natomiast  $E_t \neq E_i$  i  $|E_t - E_i| > kT$ , wówczas:

$$(\mathbf{R}_{0}\mathbf{A})_{g=r} = \frac{\sqrt{\tilde{\iota}\mathbf{n}_{0}} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_{0} \cdot \mathbf{U}_{bi}}{2 \ \mathrm{en}_{i} \cdot \mathbf{W}} \cdot \exp(|\mathbf{E}_{t} - \mathbf{E}_{i}| / \mathbf{k}T) \cdot \mathbf{U}_{t} \cdot \mathbf{$$

i (R<sub>0</sub>A)<sub>g-r</sub> rośnie wolniej niż n<sub>i</sub>-1 ze zmniejszaniem się temperatury.

Obliczmy gęstość prądu rekombinacji (U > 0) dla

najbardziej efektywnych centrów rekombinacji.

Wówczas:

$$n(z) \cdot p(z) = n_{i}^{2} \cdot exp(\frac{E_{Fp} - E_{Fn}}{kT})$$
 (36)

(gdzie E<sub>Fn</sub> i E<sub>Fp</sub> oznaczają energie poziomów Fermiego po stronie n i p złącza p-n, odpowiednio) i szybkość rekombinacji obliczona ze wzoru (27) wynosi:

$$u \stackrel{\sim}{=} \frac{1}{2 \, \stackrel{\sim}{\sim} n_0} \cdot n_i \cdot \exp\left(\frac{eU}{2 \, kT}\right) \tag{37}$$

Gęstość prądu rekombinacji wynosi wówczas:

$$J_{r} \stackrel{\simeq}{=} \frac{\frac{en_{i}W}{2}}{2\tilde{l}_{n_{0}}} \exp\left(\frac{eU}{2kT}\right)$$
(38)

a więc w stałej temperaturze T , wykres zależności ln  $J_r = f(U)$  jest linią prostą o współczynniku nachylenia e/2kT.

Gęstość prądu generacji (U < 0) dla najbardziej efektywnych centrów wyraża się następującą zależnością:

$$J_{g} = \frac{en_{i} W}{2 \tilde{\iota} n_{0}}$$
(39)

Jeśli w złączu p-n dominuje prąd generacji-rekombinacji wówczas z pomiarów charakterystyki prądowo-napięciowej przy polaryzacji zaporowej, można określić prąd generacji I i następnie korzystając ze wzoru (39) wyznaczyć wartość  $T_{n_0}$ , jeśli znane są pozostałe parametry występujące w tym wzorze, oraz powierzchnia A złącza, gdyż

$$J_{g} = \frac{I_{g}}{A}$$
(40)

Dodajmy, że w złączach p-n  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{\mathbf{1-x}}$  Te wykonanych metodą implantacji jonów, stwierdzono istotny wpływ prądu g-r na wartość parametru R<sub>0</sub>A dla temperatur T w pobliżu 77 K [32].

3.5. Powierzchniowy prąd upływowy

Na styku półprzewodnik-tlenek mogą się tworzyć tzw. stany powierzchniowe czyli poziomy energetyczne za pośrednictwem których może następować przepływ prądu, równolegie do prądu płynącego w poprzek złącza (np. prądu dyfuzyjnego czy też generacji-rekombinacji). Analogicznie jak dla złącza p-n transport nośników przez te stany może powodować powstanie prądu generacji-rekombinachi, czy też, w odpowiednich warunkach, prądu tunelowego. Jeśli stany powierzchniowe działają jak centra pułapkowe typu Shockley'a - Read'a , wówczas gęstość powierzchniowego prądu generacji wyraża się następującym wzorem:

$$J_{s} = en_{i} \cdot S_{0} \cdot W$$
 (41)

gdzie  $S_0$  jest szybkością rekombinacji powierzchniowej. Latwo zauważyć, że odpowiednia wartość parametru  $(R_0A)_s$  związanego z przepływem tego prądu zmienia się w funkcji temperatury jak  $n_i^{-1}$  a więc analogicznie jak dla procesu generacji -rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego złącza p-n. 3.6. Prąd tunelowy w złączu p-n

W fotodiodach  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te istotnym składnikiem prądu ciemnego może być prąd tunelowy, szczególnie w niskich temperaturach i dla składów molowych  $x \leq 0,2$ . Jak wspomniano wcześniej, w złączach p-n,  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te dla tych składów, obszar typu n jest zwykle zdegenerowany. Na rys.5 przedstawiono diagramy energetyczne, które można oczekiwać dla złączy p=n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te. Na diagramach zaznaczono możliwe przejścia tunelowe.

Przejścia "c" i "b" na rys.5 są możliwe z jednoczesną ekscytacją termiczną i dlatego są mniej prawdopodobne.

Tunelowanie elektronu przez klasycznie zabronioną barierę rozwiązuje się zwykle dwiema metodami, opisanymi dokładnie w [37]. Pierwsza z nich zwana metodą stanu stacjonarnego jest uogólnieniem klasycznego zagadnienia tunelowania cząstki przez prostokątną barierę potencjału na przypadek trójwymiarowy i bariery dowolnego kształtu. W metodzie tej, stosuje się tzw. przybliżenie WKB, w którym współczynnik przezroczystości D bariery dowolnego kształtu jest równy [37]

$$D = \exp(-2 K)$$
 (42)

gdzie

i

$$K = \int k(z, E_z) dz \qquad (43)$$
$$z_1(E_1)$$

 $k(z, E_z) = \left\{ 2m^* \left[ V(z) - E_z \right] / \pi^2 \right\}^{\gamma_2}$  (44)

- 28 -



Rys.5. Diagramy energetyczne złącza p-n Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te.
a) przy napięciu U = 0; b) przy U < 0; C)</p>
przy U > 0. "a", "b", "c", "d" i "e" oznaczają

możliwe przejście tunelowe: "a" - tunelowanie pasmo-pasmo , "b", "c" i "d" - tunelowanie z udziałem centrów pułapkowych, "e" - tunelowanie z poziomu akceptorowego do pasma przewodnictwa,  $E_{Fn}$  i  $E_{Fp}$  oznaczają energie poziomów Fermiego po stronie n i p złącza, odpowiednio, zaś  $E_t$ - położenie poziomu centrów pułapkowych i  $E_A$ - położenie poziomu akceptorowego.

natomiast  $E_z$  jest tą częścią energii elektronu, która jest związana z ruchem cząstki w kierunku osi z (patrz rys.2) a V(z) jest potencjałem pochodzącym od ładunku przestrzennego zgromadzonego w obszarze złącza i zewnętrznej polaryzacji złącza.

Kane [38] stosując opisaną wyżej metodę obliczył gęstość prądu tunelowego pasmo-pasmo zakładając paraboliczną zależność E( $\overline{k}$ ) dla struktury typu InSb, dla modelu dwupasmowego, otrzymując następującą zależność:

$$J_{t} = B \cdot e^{-A} D(U)$$
 (45)

gdzie

$$B = \frac{4 \, \pi \, \text{em}^{\star}}{h^3} E_{\perp} \tag{46}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\pi}{4} \left( \frac{\mathbf{E}_0}{\Theta} \right)^{3/2} \tag{47}$$

$$\mathcal{O}^{3/2} = e \operatorname{Fn}/2\pi \cdot \sqrt{2m^*}$$
 (48)

We wzorach (45)-(48)  $m^* = 2 \frac{m_e^* m_{1h}^*}{m_e^* + m_{1h}^*}$ , gdzie  $m_e^*$  jest

jest masą efektywną elektronów na dnie pasma przewodnictwa,

- 30 -

a  $m_{1h}$  masą efektywną dziur lekkich przy wierzchołku pasma walencyjnego. Dla Cd<sub>H</sub>g<sub>1-x</sub>Te  $m_e^* \cong m_{1h}^*$  i wówczas  $m^* = m_e^*$ . F jest uśrednionym natężeniem pola elektrycznego w złączu p-n.

Kane założył, że pole elektryczne odkłada się w całości w obszarze ładunku przestrzennego i zmienia się liniowo z grubością W tego obszaru. E jest energią związaną z ruchem elektronu w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku tunelowania i wyraża się wzorem:

$$\mathbf{E}_{\perp} = \Theta \left( \Theta / \mathbf{E}_{0} \right)^{1/2} \tag{49}$$

Czynnik D(U) występujący we wzorze (45) określa udział zapełnionych stanów (początkowych) i stanów pustych (końcowych) o tej samej energii E, leżących po przeciwnych stronach obszaru ładunku przestrzennego, w przejściu tunelowym. Jeśli obydwie strony złącza są zdegenerowane i temperatura jest bliska zeru, wówczas [38]

$$D(U) = e \cdot U \left[ eV \right]$$
(50)

i parametr (R<sub>O</sub>A)<sub>t</sub> związany z tunelowaniem pasmo-pasmo, obliczony na podstawie (45) i (16) wyraża się zależnością:

$$(R_0A)_t = (eB_0)^{-1} \cdot exp(+A_0) [\Omega m^2]$$
 (51)

gdzie  $A_0$  i  $B_0$  są wartościami wielkości A i B zdefiniowanymi przez (46) i (47), obliczonymi dla napięcia U = 0. Jak wynika z (51),  $(R_0A)_t$  zależy eksponencjalnie od  $E_0$ , poprzez  $A_0$ . Ponieważ w  $Cd_xHg_{1-x}Te$ , dla 0,17 < x < 0,5,  $E_0$  maleje ze zmniejszaniem się temperatury, to gdyby tunelowanie pasmo-pasmo było możliwe,  $(R_0^A)_t$  powinno też maleć eksponencjalnie ze zmniejszaniem temperatury.

Dla złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{\mathbf{1-x}}$  Te tunelowanie pasmo-pasmo jest możliwe tylko dla polaryzacji zaporowej (przejście "a" na rys.5), ponieważ tylko obszar n złącza jest zdegenerowany.

Ze względu na istnienie w  $Cd_{x}Hg_{1-x}$  Te typu p poziomów ekceptorowych położonych w niewielkiej odlagłości od wierzchołka pasma walencyjnego, możliwe są przejścia tunelowe z udziałem tych poziomów (przejście "e" na rys.5) dla niewielkiej polaryzacji napięciem w obydwu kierunkach. Wówczas przybliżenie (50) nie jest słuszne i D(U) wyraża się następującą zależnością [32]

$$D(U) \approx eU \left(\frac{kT}{kT + E_{\perp}}\right) \cdot \frac{P_0}{N_V} [eV]$$
 (52)

gdzie p<sub>0</sub> jest koncentracją dziur po stronie p zlącza p-n zaś N<sub>v</sub> efektywną gęstością stanów dla pasma dziur ciężkich:

$$N_{V} = 2 \left( \frac{2 \pi m_{hh}^{*} kT}{n^{2}} \right)^{3/2} [m^{-3}]$$
(53)

We wzorze (53)  $m_{hh}^{*}$  jest masą efektywną cięźkich dziur i dla  $Cd_{x}Hg_{1=x}Te$   $m_{hh}^{*} = 0,5 m_{0}$ , niezależnie od x i T (patrz np [39]). Licząc parametr  $(R_{0}A)_{t}$  dla D(U) wyrażonego wzorem (52) otrzymuje się następującą zależność:

$$\left(\mathbf{R}_{0}\mathbf{A}\right)_{t} = \left(\mathbf{e}\mathbf{B}_{0}\right)^{-1} \exp\left(\mathbf{A}_{0}\right) \left(\frac{\mathbf{k}\mathbf{T} + \mathbf{E}_{\perp}}{\mathbf{k}\mathbf{T}}\right) \cdot \frac{\mathbf{N}_{\mathbf{v}}}{\mathbf{p}_{0}} \left[\mathcal{Q} \ \mathbf{m}^{2}\right]$$

(54)

Ze wzoru (54) wynika, że dla wyższych temperatur gdy  $N_v/P_0 \stackrel{\sim}{=} const$ ,  $(R_0A)_t$  maleje ze zmniejszaniem się temperatury ale do momentu gdy efekt wymrażania nie stanie się decydujący. Wówczas stosunek  $N_v/P_0$  zaczyna rosnąć i  $(R_0A)_t$ również rośnie. Tak więc na charakterystyce  $(R_0A)_t$  w funkcji temperatury (a dokładniej  $T^{-1}$ ) pojawia się minimum, którego położenie zależy od  $E_A$ ,  $N_A$  i  $N_D$ . Podobne minimum uzyskano w pracy [40] w której obliczono parametr  $R_0A$  dla przejść tunelowych z udziałem poziomów pułapkowych. W pracy [40] obliczono również zależność prądu tunelowego z udziałem poziomów pułapkowych dla napięć polaryzujących złącze p-n  $Cd_{0,2}Hg_{0,8}Te$  w kierunku zaporowym dla kilku temperatur od 20 K do 80 K. Jak wynika z tych obliczeń, prąd najpierw maleje, potem rośnie i znów maleje w miarę zmniejszania się temperatury.

Jak wynika z rys.5c, przy polaryzacji złącza p-n dużym napięciem w kierunku przewodzenie, możliwe są przejścia tunelowe elektronów z pasma przewodnictwa na nieobsadzone poziomy energetyczne znajdujące się w obszarze przerwy wzbronionej po stronie p złącza p-n. Dla złączy p-n o skokowym profilu domieszek, prąd tunelowy związany z takim przejściem został obliczony w pracy [41]. Stosując metodę stanu stacjonarnego, dla przypadku gdy obydwie strony złącza p-n są zdegenerowane, otrzymano następujące wyrażenie na prąd I<sub>e</sub>:

$$\mathbf{I}_{\mathbf{e}} \stackrel{\sim}{=} \mathbf{A}' \cdot \mathbf{D}' \cdot \exp\left[-\alpha' \left(\mathbf{E}_{\mathbf{0}} - \mathbf{e}\mathbf{U} + \mathbf{E}_{\mathbf{F}\mathbf{n}} + \mathbf{E}_{\mathbf{F}\mathbf{p}}\right)\right]$$
(55)

W powyższym wzorze A' jest stałą proporcjonalną do powierzchni złącza, D' gęstością objętościową poziomów energe-

$$\alpha' = \text{const} = f(\mathbf{m}_{e}^{\star}, \mathbf{N}_{B}); \quad \mathbf{N}_{B} = \frac{\mathbf{N}_{D} \cdot \mathbf{N}_{A}}{\mathbf{N}_{D} + \mathbf{N}_{A}}$$
(56)

i prawie wcale nie zmienia się w funkcji temperatury, ponieważ m<sup>\*</sup> słabo zmienia się z temperaturą.

Jak wynika ze wzoru (55), wykres zależności ln I<sub>e</sub> = = f(U) w stałej temperaturze jest linią prostą o współczynniku nachylenia  $\mathcal{A}' \cdot e$ . Uwzględnienie we wzorze (55) faktu,że w złączach p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te strona p złącza nie jest zdegenerowana zmienia tylko wysokość bariery dla tunelującego elektronu ale nadal wykres ln I<sub>e</sub> = f(U) jest linią prostą o takim samym współczynniku nachylenia.

Prąd nadmiarowy rośnie ze wzrostem temperatury, ale współczynnik nachylenia charakterystyki ln I = f(U) pozostaje nadal równy d'.e.

Ze względu na występującą w (55) eskponencjalną zależność I<sub>e</sub> = f(U), prąd I<sub>e</sub> nazwano eskponencjalnym prądem nadmiarowym. Na rys.6 przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową dla obustronnie zdegenerowanego złącza p-n, dla obydwu polaryzacji oraz diagramy energetyczne takiego złącza, na których to pokazano przejścia: tunelowe pasmo-pasmo, eskponencjalny prąd nadmiarowy i prąd termiczny (dyfuzyjny bądź generacji-rekombinacji). Jak widać z rys.6, istnienie eskponencjalnego prądu nadmiarowego, powoduje, że obszar o ujemnej oporności jest słabiej widoczny.



i prąd termiozny.

Oprócz wymienionych uprzednio mechanizmów tunelowania przez barierę w złączu p-n , możliwe są również przejścia tunelowe z udziałem fononów, naogół widoczne tylko w niskich temperaturach (bliskich temperaturze ciekłego helu).

Tunelowanie z udziałem fononów może zachodzić żarówno w złączach p-n wykonanych z półprzewodników o skośnej jak i o prostej przerwie energetycznej. Różnica w udziałe różnych gałęzi fononów w jednym i drugim przypadku, wynika z zasady zachowania kwasipędu k . W półprzewodnikach ze skośną przerwą energetyczną pasmo przewodnictwa i pasmo walenoyjne leżą w różnych punktach strefy Brillouina (ekstrema pasm są odległe o  $\overline{k_0} \neq 0$ ) i tylko udział fononów o energii  $\hbar\omega$  ( $\overline{k_0}$ ) pozwala na przejście tunelowe pamo-pasmo, przy polaryzacji złącza napięciem takim, że  $|eU| \ge \hbar\omega(\overline{k_0})$ . Natomiast w półprzewodnikach o prostej przerwie wzbronionej pasmo przewodnictwa i walencyjne leżą w tym samym punkcie strefy Brillouina i w związku z tym,  $\overline{k_0} = 0$ . Dlatego też, w tunelowaniu mogą brać udział te fonony, dla których  $\hbar\omega$  ( $\overline{k_0} = 0$ )  $\neq 0$ , czyli fonony optyczne.

Ze względu na występujące w  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{\mathbf{1-x}}$  Te silne oddziawanie polarne z podłużnymi fononami optycznymi, tylko te uwzględnia się w tunelowaniu z udziałem fononów. Analogicznie jak poprzednio dla napięć polaryzujących  $|eU| \ge \hbar \omega_{L0}$ , gdzie  $\hbar \omega_{L0}$  jest energią fononu podłużnego optycznego, następuje wzrost przewodnictwa związany z tunelowaniem clektronów z udziałem (emisja lub absorpoja) fononów LO.

Druga metoda opisu tunelowania przez barierę to tzw. metoda hamiltonianu transferu [37], którą stosuje się do

36 .
- 37 -

opisu przejść tunelowych z uwzględnieniem istniejących w obszarze bariery dodatkowych fluktuacji potencjału, fononów lub cząstek metalicznych. W tej metodzie złącze tunelowe traktuje się początkowo jako system dwóch nieoddziaływujących ze sobą obszarów opisywanych hamiltonianami  $H_R$  i  $H_L$ , które oblicza się zakładając, że szerokość bariery jest nieskończona. Następnie wprowadza się oddziaływanie pomiędzy obydwoma obszarami opisane hamiltonianem transferu  $H_T$ , odpowiedzialnym za przenoszenie cząstek z jednego układu do drugiego. Jeśli dodatkowo uwzględni się rozpraszanie elektronów w obszarze bariery i opisze się je hamiltonianem  $H_X$ , wówczas całkowity hamiltonian zaburzenia  $H_L$  jest równy

$$H_{c} = H_{T} + H_{x}$$
(57)

Jeśli całkowite zaburzenie opisywane hamiltonianem H<sub>c</sub> jest słabe, wówczas do obliczenia prawdopodobleństwa przejścia zastosować można rachunek zaburzeń.

Szczególnie interesujący jest przypadek, gdy w obszarze bariery znajduje się potencjał zlokalizowany typu studni potencjału, pochodzący od jakiegoś defektu. W wyniku istnienia tego potencjału może utworzyć się poziom energetyczny  $E_{R_0}$ położony wewnątrz studni. Na rys.7 przedstawiono złącze typu MIS w którym istnieje w obszarze bariery taki potencjał. Zaznaczono również odpowiadający mu poziom  $E_{R_0}$ .

Jeśli spolaryzuje się złącze napięciem takim, że poziom Fermiego po jednej lub po drugiej stronie złącza znajdzie się naprzeciw  $\mathbf{E}_{\mathbf{R}_{O}}$  wówczas możliwe będzie tunelowanie rezonansowe



Rys.7. Bariera typu MIS zawierająca poziom rezonansowy E<sub>RO</sub> który byłby stanem związanym, gdyby bariera była nieskończenie szeroka. Półprzewodnik w złączu MIS odpowiada stronie n złącza p-n.

38

poprzez poziom  $E_{R_0}$ . Poziom rezonansowy powoduje nagły wzrost współczynnika transmisji T przez barierę dla  $E = E_{R_0}$  [42]

$$|\mathbf{T}|^{2}/|\mathbf{T}_{0}|^{2} = 1 + \frac{|\mathbf{T}_{2}|^{2}}{(\mathbf{E} - \mathbf{E}_{R_{0}})^{2} + |\mathbf{T}_{2}|^{2}} - \frac{|\mathbf{T}_{a}|^{2}}{|\mathbf{T}_{0}|^{2}}$$
 (58)

gdzie

$$|T_a|^2 = c_3 \int_L \int_R /(\int_L + \int_R)$$
 (59)

We wzorach (58) i (59) c<sub>3</sub> jest proporcjonalne do liczby defektów zaś

$$|\mathbf{T}_0|^2 \cong e^{-2kW}$$
 (60)

jest szerokością poziomu rezonansowego i

$$\int = \int_{\mathbf{L}} + \int_{\mathbf{R}}$$
(61)

 $\Gamma_{L}$  i  $\Gamma_{R}$  jest takie, że  $\Gamma_{L}/\hbar$  i  $\Gamma_{R}/\hbar$  jest prawdopodobieństwem przejścia tunelowego na jednostkę czasu do lewego i prawego obszaru, odpowiednio. Dla  $\Gamma_{L} = \Gamma_{R}$ , prawdopodobieństwo przejścia  $|T|^{2}/|T_{0}|^{2}$ , wyrażone wzorem (58), z jednego obszaru do drugiego jest maksymalne i wówczas występuje rezonansowe tunelowanie. Jeśli zaś  $\Gamma_{R} \neq \Gamma_{L}$ , efekt tunelowania jest odpowiednio słabszy. Tak więc istnienie defektów w obszarze bariery złącza powoduje wzrost prądu płynącego przez złącze, szczególnie w przypadku tunelowania rezonansowego.

Załóżmy za autorami pracy [43], że energia poziomu rezonansowego, liczona względem poziomu Fermiego w prawej elektrodzie, zmienia się liniowo w funkcji napięcia polaryzującego zlącze

$$E_{R} = E_{R_{O}} + eLU$$
 (62)

Jeśli założymy, że całe napięcie odkłada się na barierze, wówczas L zmienia się od wartości -1 (jeśli defekt jest po lewej stronie) do O (jeśli defekt jest po prawej stronie) w zależności od miejsca położenia defektu w obszarze bariery.

Na rys.8 przedstawiono przykładowo jakościową zmianę przewodnictwa dI/dU w funkcji napięcia polaryzującego złącze, dla  $E_{R_0} > 0$  i L = -1 wywołaną tunelowaniem rezonansowym. Dla przypadku pokazanego na tym rysunku, kanał tunelowania rezonansowego otwiera się dla napięć polaryzujących złącze w kierunku przewodzenia większych od  $E_{R_0}/e$ . W konsekwencji, tunelowanie nieelastyczne z udziałem fononów będzie możliwe tylko gdy otwarty jest kanał tunelowania rezonansowego,



Rys.8. Zmiana przewodnictwa związana z tunelowaniem rezonansowym dla złącza typu MIS, dla  $E_{R_0} > 0$ i L = -1 wg [43].

a więc w przypadku przedstawionym na rys.8, dla napięć polaryzujących złącze tylko w kierunku przewodzenia i takich, że

$$e U \ge \hbar \omega_{L_0} + |E_{R_0}|$$
 (63)

Jak pokazano w [42] zmiana przewodnictwa występująca w pobliżu zerowej polaryzacji (tzw. anomalia zerowa) wywołana tunelowaniem rezonansowym w niskich temperaturach jest liniową funkcją temperatury. Całkowita zmiana przewodnictwa (T) jest proporcjonalna do:

$$G(T) \sim (U^2 + \gamma T^2)^{1/2}$$
 (64)

gdzie f jest stałą. Parametr  $(R_0^A)_r$ , związany z tunelowaniem rezonansowym wyraża się wówczas następująco:

$$(R A)_{\tau} \sim \frac{1}{(U^2 + \gamma T^2)^{1/2}}$$
(65)

Współczynnik y występujący we wzorze (64) można określić z eksperymentu. W wielu tunelowych złączach p-n wykonanych z materiałów AIII-BV o niskim poziomie domieszkowania, zaobserwowano występowanie osobliwości na charakterystykach prądowo-napięciowych w temperaturach bliskich i równych T = 4,2 K, których istnienie wiąże się z udziałem fononów LO w tunelowaniu [43-48].

Na rys.9 przedstawiono wg [44] zależność przewodnictwa w funkcji napięcia polaryzującego złącze p-n dla kilku złączy z grupy AIII-BV.



Rys.9. Przewodnictwo tunelowe w T = 4,2 K dla złączy p-n grupy III-V. Jedynie w GaSb występuje obszar o ujemnej oporności. Strzałki wskazują osobliwości występujące przy napięciach  $eU = \hbar \omega_{10}$  [44].

Określone w [44] w sposób taki jak na rys.9 energie fononów LO dobrze zgadzają się z wartościami  $\hbar\omega$  otrzymanymi drogą innych eksperymentów. Badając zależności przewodnictwa w funkcji napięcia i temperatury dla tych złączy w [43-48] stwierdzono że: 1) w pobliżu zerowego napięcia lub dla U = 0 pojawia się osobliwość (anomalia zerowa); 2) dla napięć polaryzujących złącze w kierunku przewodzenia pojawiają się osobliwości i 3) zarówno zerowa anomalia jak i w/w osobliwości znikają przy podwyższeniu temperatury do ok. 20 - 30 K. Próby wyjaśnienia tych efektów tunelowaniem jednocząstkowym przez uśrednioną barierę z udziałem fononów nie powiodły się, gdyż nie tłumaczyły asymetrii występujących osobliwości względem polaryzacji złącza. Analogiczne rezultaty otrzymano gdy uwzględniono oprócz fononów udział poziomów pułapkowych. Występowanie tych efektów tłumaczy się tunelowaniem rezonansowym [43,49]. Za anomalię zerową jest odpowiedzialne rezonansowe tunelowanie poprzez poziom energetyczny pochodzący od defektu znajdującego się w obszarze bariery w pobliżu strony p-złącza.

Dla złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$ Te obszar typu p zwykle nie jest zdegenerowany i tunelowanie rezonansowe jest możliwe ale tylko na nieobsadzone poziomy energetyczne znajdujące się w przerwie energetycznej po stronie p złącza.

Osobliwości pojawiające się przy wyższych napięciach polaryzujących mogą być związane z tunelowaniem rezonansowym poprzez defekt ale z udziałem fononów bądź innych poziomów energetycznych znajdujących się w obszarze przerwy energetycznej po stronie p złącza. Sytuację tą ilustruje rys.10 na którym przedstawiono diagram energetyczny dla złącza p-n Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te spolaryzowanego napięciem w kierunku przewodzenia i możliwe przejścia tunelowe rezonansowe.

- 42 -



Rys.10. Diagramy energetyczne złącza p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te spolaryzowanego napięciem U<sub>1</sub> i U<sub>2</sub> (rys.10a i b) w kierunku przewodzenia. Na rysunkach oznaczono możliwe przejścia tunelowe rezonansowe z udziałem defektu (kółka) znajdującego się w pobliżu obszaru p-złącza. Przejście "f" i "g" są przejściami na nieobsadzone poziomy akceptorowe E<sub>A i</sub> i E<sub>A o</sub>dpowiednio, zaś przejście "h" jest przejściem z emisją fononu o energii  $\hbar \omega_{L0}$ .

43 -

- 44 -

## 3.7. Pojemność zlącza p-n

W praktyce mamy zwykle do czynienia z dwojakiego rodzaju złączem p-n. Złącza o skokowym profilu domieszek (t = 2), to zwykle złącze stopowe i płytkie złącze dyfuzyjne, podczas gdy drugi rodzaj złączy to złącza o liniowym rozkładzie domieszek (t = 3) i są to tzw. głębokie złącza dyfuzyjne [31].

Dla pierwszego rodzaju złączy, zależność pojemności na jednostkę powierzchni w funkcji napięcia polaryzującego złącze jest następująca [31]

$$C = \begin{bmatrix} \frac{e \mathcal{E}_0 \mathcal{E}_s N_B}{2(U_{bi} \stackrel{t}{=} U)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{F}{m^2} \end{bmatrix}$$
(66)

przy czym znaki <sup>+</sup> dotyczą polaryzacji w kierunku zaporowym i przewodzenia, odpowiednio, zaś N<sub>B</sub> jest określone następująco:

$$N_{B} = \frac{N_{D} \cdot N_{A}}{N_{D} + N_{A}} \left[m^{-3}\right]$$
(67)

Szerokość W dla tych złączy w funkcji napięcia zmienia się następująco: 1/2

$$W = \left[\frac{2 \mathcal{E}_{O} \mathcal{E}_{s} (U_{bi} \stackrel{+}{=} U)}{e N_{B}}\right]^{1/2} [m]$$
(68)

Przekształcając wzór (66) otrzymujemy:

$$c^{-2} = \frac{2}{e \, \varepsilon_0 \, \varepsilon_s \, N_B} \cdot (\mathbf{u}_{bi} \, \overset{\pm}{=} \, \mathbf{u}) \tag{69}$$

- 45 -

Wykres zależności  $C^{-2} = f(-U)$  jest linią prostą o współczynniku nachylenia  $2/e \xi_0 \xi_s N_B$  przecinającą oś napięcia przy  $U = U_{bi}$ .

Zwykle  $N_B$  i  $U_{bi}$  określa się z charakterystyk C = f(U)dla kierunku zaporowego. Przy analizie charakterystyk C=f(U)dla napięć polaryzujących złącze w kierunku przewodzenia nie powinno się stosować powyższych wzorów, gdyż do pojemności obszaru ładunku przestrzennego dodaje się pojemność dyfuzyjna złącza [31].

Dla złączy o liniowym rozkładzie domieszek, wykładnikiem potęgi we wzorach (66) i (68) jest  $\frac{1}{3}$  (czyli t=3) i zamiast N<sub>B</sub>, występuje parametr a, określający gradient koncentracji nośników w obszarze złącza, pomnożony przez szerokość złącza. Dla takich złączy, wykres  $C^{-3} = f(U)$  jest linią prostą przecinającą oś napięcia przy  $U = U_{bi}$  [31].

## 4. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA

4.1. Wykonanie złączy p-n w Cd\_Hg1-x Te .

46

Badane złącza wykonane zostały w warstwach epitaksjalnych Cd\_Hg1\_x Te otrzymanych metodą IVPE czyli izotermicznego osadzania warstwy epitaksjalnej z fazy gazowej [1,50], przez dr P.Beclę. Izotermiczna epitaksja Cd\_Hg,\_Te z fazy gazowej, chętnie stosowana ze względu na prostotę warunków technologicznych [51] przebiega w zamkniętym układzie w którym jest umieszczone podłoże CdTe oraz  $(Hg_zCd_{1-z})_yTe_{1-y}$  stanowiący materiał źródła epitaksji. Wzrost warstwy zachodzi w zakresie temperatur 820 K do 920 K, w wyniku występowania procesów parowania, kondensacji oraz dyfuzji. Różnica ciśnień dysocjacji podłoża i materiału źródła prowadzi do transportu gazowego składników źródła do podłoża i procesu kondensacji. W procesie adsorpeji na podłożu, z atomowych składników tworzą się cząsteczki stabilnego związku. Proces kondensacji trwa tak długo, jak długo istnieje różnica potencjałów chemicznych narastającej warstwy i materialu źródła. Różnica ta, jest podtrzymywana dzięki występowaniu zjawiska wzajemnej dyfuzji rtęci i kadmu w kondensującej warstwie oraz podłożu. W efekcie, otrzymuje się warstwę epitaksjalną z gradientem składu. Na powierzchni warstwy otrzymuje się skład i typ przewodnictwa zależny od składu y materiału źródła i temperatury źródła. Rys.11 przedstawia zależność profilu składu warstwy epitaksjalnej HgCdTe z fazy gazowej od różnych składów materiału źródła. Jednocześnie rysunek ten obrazuje wpływ składu materiału źródła na grubość

warstwy i jej skład na powierzchni.

- 47



Rys.11. Profile składów warstw epitaksjalnych HgCdTe z fazy gazowej dla różnych składów materiału źródła: 1 - HgTe ; 2 -  $Hg_{0,45}Te_{0,55}$ ; 3 -  $(Hg_{0,9}Cd_{0,1})_{0,45}Te_{0,55}$ ; 4 -  $(Hg_{0,9}Cd_{0,1})_{0.41}$ Te<sub>0,59</sub> (z pracy [50]).

Aby otrzymać złącze p-n , tak otrzymane warstwy epitaksjalne (na ogół po odcięciu od podłoża) domieszkuje się w oelu uzyskania przypowierzchniowej warstwy o przeciwnym typie przewodnictwa. Jedną z metod domieszkowania, zastosowaną w celu otrzymania badanych w niniejszej pracy złączy, jest wygrzewanie warstwy epitaksjalnej  $Cd_xHg_{1-x}Te$  typu p w nasyconych parach rtęci [1,50,51]. Oprócz stosowanej tu technologii istnieje wiele różnych metod otrzymywania złączy p-n na bazie kryształów mieszanych  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . Przegląd stosowanych metod i porównanie własności otrzymanych z ich pomocą złączy p-n  $Cd_xHg_{1-x}Te$  przedstawiono w [32,51].

Dla złączy badanych w tej pracy materiałem źródła był  $Hg_{0.45}^{Te}$ . Wzrost warstwy przeprowadzano w temperaturze

- 48 -

T = 890.K w czasie jednego tygodnia. Otrzymane warstwy mialy grubość rzędu 400 ÷ 500 µm. Następnie warstwy odcinano od podłoża wzdłuż płaszczyzny równoległej do gradientu składu i szlifowano (od strony większych składów x) dla uzyskania żądanej wartości składu. Tak przygotowane warstwy miały grubość rzędu 100 ÷ 150 µm . Warstwy te były typu p z koncentracją akceptorów  $N_{A} = 0,7 \div 3 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$  określoną z pomiarów efektu Halla. Następnie warstwy domieszkowano przypowierzchniowo na typ n poprzez wygrzewanie w nasyconych parach rtęci. Temperatura wygrzewania była równa ok. 570 K zaś temperatura źródła rtęci ok.550 K. Czas wygrzewania wynosił 0,5 h, 1 h i 1,5 h dla złączy z serii A, B i C, odpowiednio oraz 5 h dla serii Z i 2 h dla pozostałych serii złączy. Grubość przypowierzchniowej warstwy typu n wahała się od kilku do około 10  $\mu$ m, zaś szacowana różnica koncentracji N<sub>D</sub> N<sub>A</sub> w warstwie typu n, była rzędu  $10^{22} \text{ m}^{-3}$  [52]. Tak otrzymane złącza. wytrawiono techniką MESA. Jako kontakty elektryczne stosowano zloto do obszaru typu p oraz ind do obszaru typu n .

4.2. Układy pomiarowe.

Na rys.12 przedstawiono układ zastosowany do pomiarów efektu fotowoltaicznego. Modulowaną wiązkę monochromatycznej fali elektromagnetycznej wychodzącą ze szczeliny wyjściowej monochromatora SPM-2, po odbiciu od sferycznego zwierciadła Z-3, dzielono na zwierciadle półprzepuszczalnym na dwie wiązki zbieżne: pomiarową i odniesienia. Wiązkę pomiarową ogniskowano na powierzchni detektora D umieszczonego w kriostacie



Rys. 12.

50 -

azotowym w którym stosowano okienka z  $\operatorname{CaF}_2$  (dla  $\lambda < 9 \mu$ m) lub z KRS-5 (dla  $\lambda > 9 \mu$ m). Wiązkę odniesienia ogniskowano na powierzchni termoogniwa T (Zeiss Vth-1) z okienkiem z  $\operatorname{CaF}_2$  lub z okienkiem z KRS-5. Sygnał napięciowy z detektora i z termoogniwa mierzono po wzmocnieniu nanowoltomierzem homodynowym typu 232-B, zsynchronizowanym z częstotliwością obrotów modulatora M. Częstotliwość modulacji wiązki światła wynosiła 12 Hz. Jako źródeł światła L<sub>0</sub> używano lampę halogenową (dla  $\lambda < 2,5 \mu$ m) oraz pręt globara (dla  $\lambda > 2,5 \mu$ m)

Na rys.13 przedstawiono schemat układu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych.

Złącze polaryzowano za pomocą baterii anodowej BAS-80-L-09. Użyto rejestratora firmy Ricken-Denshi. Dla złączy o dużej oporności stosowano pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych metodą punkt po punkcie. Napięcie na złączu p-n mierzono woltomierzem V-623 natomiast pomiaru prądu dokonywano poprzez pomiar spadku napięcia na oporniku R<sub>3</sub> o znanej oporności, za pomocą woltomierza cyfrowego V 544.

Metoda pomiaru oporności różniczkowej dU/dI i jej pochodnej d<sup>2</sup>U/dI<sup>2</sup> w funkcji napięcia polaryzującego polega na tym, że do złącza p-n oprócz stałego napięcia polaryzującego, przykłada się mały sygnał napięcia zmiennego sinusoidalnie, a następnie za pomocą detektora fazoczułego mierzy się pierwszą i drugą harmoniczną częstotliwości sygnału sinusoidalnie zmiennego. Jeśli amplituda  $\delta$  sygnału zmiennego sinusoidalnie o częstości  $\omega$  jest stała, wówczas napięcie U na złączu p-n można rozłożyć na szereg Taylora. Jeśli całko-





$$U(I) = U(I_0) + \left(\frac{dU}{dI}\right) \delta \cos \omega t + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2U}{dI^2}\right) \delta^2 \cos^2 \omega t + \frac{1}$$

$$= U(I_0) + \left(\frac{dU}{dI}\right) \delta \cos \omega t + \frac{1}{4} \left(\frac{d^2U}{dI^2}\right) \delta^2 (1 + \cos 2\omega t) + \dots$$
(70)

gdzie U(I<sub>0</sub>) jest napięciem stałym na złączu p-n . Jak widać, pierwsza harmoniczna napięcia zmiennego na złączu ο częstości ω, jest proporcjonalna do oporności róźniczkowej dU/dI zaś druga harmoniczna o częstości 2  $\omega$  jest proporcjonalna do pierwszej pochodnej oporności różniczkowej, tj. do d<sup>2</sup>U/dI<sup>2</sup>.

Na rys.14 przedstawiono schemat układu zastosowanego do pomiaru oporności różniczkowej i jej pochodnej badanych złączy. W układzie tym, sygnał sinusoidalnie zmiennego napięcia z generatora funkcyjnego G-432 przykładano do złącza p-n



Rys.14. Schemat układu do pomiaru oporności różniczkowej i jej pochodnej w funkcji napięcia polaryzującego złącza p-n.

za pomocą transformatora podwyższającego napięcie. Stosowano częstotliwość f  $\cong$  800 Hz. Zastosowano rejestrator XY firmy

52 -

Ricken-Denshi oraz nanowoltomierz homodynowy typ 232-b jako detektor fazoczuły. Sygnał odniesienia do nanowoltomierza pobierano z osobnego wyjścia generatora G-432.

Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych, oporności różniczkowej i jej pochodnej wykonywano w funkcji temperatury od 4.2 K do 300 K. Do pomiarów temperatury stosowano termoparę Au + 5% Fe - Chromel.

Pomiary pojemności złączy p-n w funkcji napięcia polaryzującego złącza wykonano w temperaturze ciekłego azotu. Zastosowano precyzyjny miernik pojemności Mf-309. Miernik ten posiada wbudowany zasilacz napięcia stałego umożliwiający polaryzację złącza napięciem stałym w zakresie od -25 V do + 25 V. Pomiary napięcia przykładanego do złącza wykonano za pomocą woltomierza cyfrowego V 544.

4.3. Wyniki pomiarów.

W pracy przebadano 40 złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te podzielonych na cztery grupy. Złącza na zakres długości fal 1 µm  $\langle \lambda |_{C_0}(77) \rangle \langle 2 |_{UM}$  zaliczono do grupy I, złącza na zakres  $\lambda |_{C_0}(77) \rangle \langle 6 |_{UM}$  do grupy IV. Złącza na zakres od 2 µm do 6 µm podzielono na dwie grupy. Jedną stanowiły złącza dla których w zakresie temperatur od 4.2 K do ok. 100 K na charakterystykach prądowo-napięciowych spolaryzowanych w kierunku przewodzenie pojawia się przegięcie (grupa III) oraz pozostałe (grupa II).

Parametry części badanych złączy przedstawiono w tabeli I . W tabeli I graniczną długość fali  $\lambda_{C_0}(77)$  okreś-

Grupa	Złącze	λc <sub>o</sub> w 77 K μm	Е <sub>О</sub> ₩ 77 К еV	x	Współczyn. nachylenia lnI=f(U) w 77 K v <sup>-1</sup>	Parametr t	U <sub>bi</sub> V
I	F-1 Z-10 Z-6	1.15 1.5 1.65	1.08 0.83 0.8	0.8 0.627 0.59	2 7 21	2 2 2.6	1.46 0.8 0.7
II	F-3 Z-14 E-4 E-3 E-2 A-2	2.88 3.22 3.96 4.15 4.5 5.0	0.43 0.39 0.31 0.3 0.28 0.25	0.41 0.38 0.34 0.33 0.31 0.3	21 8 30 17 31 28	1.7 2 2 2 2 2	0.43 0.4 0.33 0.2 0.25
III .	A~5 H-1 C-1 F-5 Z~1	3.56 3.66 3.9 4.0 4.3	0.35 0.34 0.32 0.31 0.29	0.36 0.357 0.342 0.33 0.32	18 31 33 22 58	2 2 2 1 2	0.4 0.4 0.4 0.3 0.31
IV	P-138 Z-11 Z-13 P-189 D-6 P-180 B-5 B-4 B-3 B-1 A-3 P-181 B-2 C-2 P-182 D-1	6.4 6.5 7.3 7.5 8.4 8.5 9.1 9.2 9.5 9.8 9.9 10.3 11.5 12.4 14.6 17.2	0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11 0.08 0.07	0.262 0.26 0.248 0.24 0.23 0.227 0.226 0.223 0.221 0.221 0.22 0.215 0.209 0.205 0.209 0.205 0.2 0.186	18 51 50 20 27 26 17 21 46 25 40	22	0.25 0.23

Tabela I

54

.

lono aproksymując liniowo do przecięcia z osią  $\lambda$  spadek fotoodpowiedzi od strony długofalowej (patrz rys.15,21,35). Tak określona wartość  $\lambda_{C_0}(77)$  posłużyła do obliczenia  $E_0(77)$  i składu molowego X. Jeśli wartość  $\lambda_{C_0}(77)$  określić jako wartość  $\lambda$ , przy której fotoodpowiedź spada do ok. 50% swojej wartości szczytowej, to wówczas wartości  $E_0$  i x są większe o ok.8 % od poprzednio wyznaczonych. Błąd  $\Delta\lambda_{C_0}(77)$ wynika z dokładności pomiaru  $\lambda$  za pomocą monochromatora SPM-2. I tak, dla złączy grupy I-III,  $\Delta\lambda_{C_0}(77) = \pm 0,02 \,\mu\text{m}$ , natomiast dla złączy grupy IV,  $\Delta\lambda_{C_0}(77) = \pm 0,2 \,\mu\text{m}$ . Związany z tym błędem względny błąd  $\Delta E_0/E_0$  i  $\Delta x/x$  jest mniejszy od 1% dla złączy grupy I-III i równy ok. 3% dla złączy grupy IV.

W tabeli I zebrano współczymiki nachylenia charakterystyk lnI = f(U) zmierzonych w T = 77 K dla napięć polaryzujących złącza w kierunku przewodzenia, a także parametr t i wysokość bariery  $U_{bi}$ , wyznaczone z pomiarów pojemności w funkcji napięcia w 77 K.

<u>Dla złączy grupy I</u>, krawędź efektu fotowoltaicznego jest ostro rosnąca. Zwraca także uwagę dość silny spadek fotoodpowiedzi po wysoko energetycznej stronie charakterystyki. Na rys.15 przedstawiono przykładowo charakterystyki efektu PV dla złączy Z-10 i Z-6.

Dla polaryzacji w kierunku zaporowym wartość prądu płynącego przez te złącza maleje wraz ze zmniejszaniem się temperatury i ich własności prostujące polepszają się . W wyższych temperaturach, wartość napięcia polaryzującego złącze p-n w kierunku przewodzenia, przy którym prąd wyraźnie wzras-

55 -



dużo powyżej wartości  $E_0/e$ . Na rys.16 przedstawiono przykładowo charakterystyki prądowo-napięciowe dla złącza Z-10 dla różnych temperatur.

Na rys.17 przedstawiono zależność log I = f(U) dla polaryzacji w kierunku przewodzenia dla złącza Z=6 w T = 4,2 K , 77 K i 300 K . W T = 4.2 K i T = 300 K zależność ta jest mieliniowa w zakresie napięć U  $\leq E_0/e$  . W T = 77 K charakterystyka log I = f(U) jest liniowa w zakresie napięć 0,58 V < U < 0,72 V . Współczynnik nachyle= nia charakterystyki ln I = f(U) wynosi ok. 21 V<sup>-1</sup>. Podobne charakterystyki log I = f(U) zaobserwowano dla pozostałych złączy grupy I.

Dla tej grupy zlączy, na charakterystykach oporności różniczkowej dU/dI, w funkcji napięcia polaryzacji U pojawia się tzw. zerowa anomalia, malejąca w miarę wzrostu temperatury. Na rys.18 przedstawiono przykładowo zależność dU/dI = f(U) w kilku temperaturach (od 6 K do 35 K) dla złącza Z=6. Na charakterystykach tych łatwo zauważyć, że wzrasta wartość napięcia przy którym oporność maleje gwałtownie, dla napięć polaryzujących złącze w kierunku przewodzenia, w miarę zmniejszania się temperatury (strzałki na rys.18).

Na rys.19 przedstawiono zależność  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złączy grupy I. Linią prostą zaznaczono nachylenie zależności  $n_i^{-1} = f(\frac{10^3}{T})$ , otrzymane dla złącza Z-6 ze wzoru (5). Takiej zależności nie obserwuje się dla złączy Z-10 i F-1 do temperatury pokojowej włącznie. Jedynie dla złącza Z-6 parametr  $R_0^A$  zmienia się w funkcji odwrotności temperatury jak  $n_i^{-1}$  (dla T > 280 K).







Rys. 18. Charakterystyka dU/dI = f(U) dla złącza Z-6dla kilku temperatur od 6 K do 35 K.

Z pomiarów pojemności C w funkcji napięcia U określono parametr t (związany z profilem domieszkowania). Wynosi on : t = 2 dla złączy F-1 i Z-10 oraz t = 2,6 dla złącza Z-6. Z przecięcia charakterystyki  $C^{-t} = f(U)$  z osią napięcia wyznaczono wysokości barier U<sub>bi</sub> (patrz tabela I). Na rys.20 przedstawiono przykładowo zależność  $C^{-t} = f(U)$  dla złącza Z-6 w T = 77 K.





62

złącza Z-6.

ka C = f(U) w T = 77 K dla

<u>Złącza grupy II</u> mają podobne charakterystyki efektu PV (patrz rys.21) i prądowo-napięciowe do charakterystyk dla złączy grupy I. Współczynniki nachylenia charakterystyk ln I = f(U) w T = 77 K dla polaryzacji w kierunku przewodzenia mają wyższą wartość niż w wypadku złączy grupy I (patrz tabela I). Na rys.22 przedstawiono przykładową zależność log I = f(U) dla złącza E-4.



E - 4 (w 77 K),





W wypadku tych złączy, na charakterystykach oporności różniczkowej dU/dI w funkcji napięcia U pojawia się także zerowa anomalia w T = 4.2 K, znikająca przy podwyższeniu temperatury do ok. 20 K. Ilustrują to rysunki 23 i 24 na których przedstawiono zależność dU/dI = f(U) dla złącza E-4dla kilkunastu temperatur od 4.2 K do 20 K. Napięcie (polaryzujące złącze w kierunku przewodzenia), przy którym oporność złącza gwaltownie maleje, jest dla tych złączy w wyższych temperaturach równe w przybliżeniu E<sub>0</sub>/e i rośnie wraz ze zmniejszaniem się temperatury do 4.2 K ale nie rośnie aż tak jak w złączach grupy I. Na rys.25 przedstawiono przykładowo zależność  $d^2 U/dI^2 = f(U) dla złącza E-4 dla kilku tempera$ tur w pobliżu T = 4,2 K. Występująca na tej charakterystyce osobliwość związana ze zmniejszaniem się oporności złącza dla polaryzacji w kierunku przewodzenie przesuwa się tylko o kilkadziesiąt meV w zakresie temperatur od 4.2 K do 12 K.

W tej grupie złączy, na charakterysykach  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$ daje się wyraźnie zauważyć zakres temperatur w którym  $R_0A$ jest proporcjonalne do  $n_i^{-1}$ . Na rys.26 przedstawiono przykładowo zależność  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złączy F-3, Z-14 i E-4. Parametr  $R_0A$  dla złączy F-3 i Z-14 zmienia się jak  $n_i^{-1}$  w T > ok.220 K, zaś dla E-4 zmienia się tak w T > ok.200 K. Natomiast w T < 220 K słabo rośnie w miarę zmniejszania się temperatury do ok. 77 K, zaś przy dalszym zmniejszaniu się temperatury do 4.2 K rośnie prawie liniowo. Na rys.27 przedstawiono przykładowo zależność  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$ w całym zakresie mierzonych temperatur od 4.2 K do 300 K dla złączy F-3 i E-4.



Rys.23. Charakterystyka dU/dI = f(U) dla złącza E-4 dla kilku temperatur od 4.2 K do 9 K.



Rys.24. Charakterystyka dU/dI = f(U) dla złącza E-4dla kilku temperatur od 12 K do 20 K.



Rys.25. Charakterystyka  $d^2U/dI^2 = f(U) dla złącza - E-4 dla kilku temperatur od 4.2 K do 12 K.$ 





Z pomiarów charakterystyk C = f(U) określono wartość parametru t, który dla złączy serii E i złączy Z-14 i A-2 wynosi t = 2, natomiast dla złącza F-3 wynosi t = 1.7. Na rys.28 przedstawiono przykładowo zależność  $C^{-t} = f(U)$  dla złącza F-3 w 77 K.

Dia złączy grupy III wartość  $\lambda c_0(77)$  wynosi ok.4 µm. Są to złącza A-5, C-1, F-5, H-1 i Ze1. Na rys.29 przedstawiono przykładowo charakterystykę I = f(U) dla złącza A-5 w 77 K, dla polaryzacji w kierunku przewodzenia. Natomiast charakterystyki prądowo-napięciowe dla polaryzacji zaporowej zachowują się następująco: dla dużych napięć polaryzujących, prąd najpierw maleje, potem rośnie i znów maleje, w miarę zmniejszania się temperatury. Na rys.30 przedstawiono przykładowo charakterystyki. I = f(U) dla złącza H-1, dla kilku temperatur od 15 K do 167 K. Na charakterystykach dU/dI = = f(U) obserwuje się w tych złączach anomalię zerową, tak jak i w poprzednich grupach, w T = 4.2 K, aż do ok. 20 K. Obserwuje się także spadek oporności złącza przy polaryzacji napięciem U w kierunku przewodzenia o wartóści eU  $\cong$  E<sub>0</sub> , nawet w temperaturach bliskich temperaturze cieklego helu. Ilustruje to rys. 31, na którym przedstawiono przykładowo charakterystykę dU/dI = f(U) dla złącza F-5 dla kilku temperatur od 6 K do 22 K. Strzałkami zaznaczono napięcie przy którym następuje gwaltowny spadek oporności.

Dla złączy tej grupy zaobserwowano na charakterystykach  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  minimum, w zakresie temperatur od ok. 40 K do 80 K. Na rys.32 przedstawiono przykładowo zależność  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złączy F-5 i H-1. W wyższych temperaturach,




Rys.29. Charakterystyka I = f(U) (dla polaryzacji w kierunku przewodzenia) dla złącza A=5 w 77 K.



Rys.30. Charakterystyki I = f(U) dla złącza H-1 dla kilku temperatur od 15 K do 167 K.



Rys.31. Charakterystyki dU/dI = f(U) dla złączaF-5, dla kilku temperatur od 6 K do 22 K.



Rys.32.  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złączy F-5 i H-1 w całym zakresie mierzonych temperatur od 4.2 K do 300 K.



 $R_0^A$  zachowuje się jak  $n_i^{-1}$ , a w pobliżu temperatury pokojowej jak  $n_i^{-2}$ . Na rys.33 przedstawiono przykładową zależność  $R_0^A = f\left(\frac{10^3}{T}\right)$  dla złącza H-1 w węższym zakresie temperatur (od 100 K do 300 K).

Z pomiarów charakterystyk C = f(U) określono wartość parametru t , która wynosi t = 2 dla wszystkich złączy tej grupy, za wyjątkiem złącza F-5, dla którego t = 1. Na rys. 34 przedstawiono przykładowo zależność  $C^{-t} = f(U)$  dla złącza Z-1 w 77 K.



Z-1 w 77 K.

Dla czwartej grupy złączy , krawędzie charakterystyki efektu PV rosną mniej ostro niż dla poprzednich trzech grup. Przykładowo, na rys.35 przedstawiono charakterystykę dla złącza B-1 w T = 77 K. Dla złączy tej gru-PV efektu py, dla polaryzacji napięciem w kierunku przewodzenia (szczególnie w niższych temperaturach) dają się zaobserwować dwa zakresy napięć, dla których zależność log I = f(U) jest prostoliniowa. Ilustruje to rys. 36 na którym przedstawiono przykładowo zależność log I = f(U) dla złącza B-2 w T = 4.2K. Pierwszy zakres, o mniejszym współczynniku nachylenia, występuje dla napięć U <  $E_0/e$ , zaś drugi, dla napięć U  $\stackrel{\sim}{=} E_0/e$ , o większym współczynniku. Prąd płynący przez te złącza, dla polaryzacji zaporowej, najpierw maleje ze zmniejszaniem się temperatury, potem rośnie i znów maleje, tak jak to miało miejsce dla złączy grupy III.

Rysunek 37 przedstawia przykładową zależność I = f(U) dla kilku temperatur od 6 K do 110 K dla złącza D-6. Na charakterystykach oporności różniczkowej dU/dI w funkcji napięcia pojawia się zerowa anomalia, która znika ze wzrosz tem temperatury powyżej  $\stackrel{\sim}{=} 25$  K podobnie jak w poprzednich grupach złączy. Maksimum zerowej anomalii występuje dla wartości napięć 0  $\leq$  eU  $\leq$  kilka meV . Na rys. 38 przedstawiono przykładowo zależność dU/dI = f(U) dla złącza P-138 w kilku temperaturach od 4.2 K do 40 K. Pojawiają się też osobliwości, ale tylko dla napięć polaryzujących złącza w kierunku przewodzenia, lepiej widoczne na charakterystykach d<sup>2</sup>U/dI<sup>2</sup> = f(U) i znikające powyżej T  $\stackrel{\sim}{=}$  30 K. Na rysunku 39 przedstawiono przykładowo zależność d<sup>2</sup>U/dI<sup>2</sup> = f(U) dla złącza P-138 w T = 4.2 K.

79 -





Rys. 36. Charakterystyka  $\log I = f(U) = 4.2 K$ dla złącza B-2.

Na zależnościach  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  pojawia się minimum tak jak to miało miejsce w wypadku złączy grupy III. Na rys.40 przedstawiono przykładowe zależności  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$ dla kilku złączy p-n z tej grupy. Ze wzrostem temperatury (powyżej obszaru minimum), parametr  $R_0^A$  zachowuje się jak



Rys.37. Charakterystyki I = f(U) dla złącza D=6 dla kilku temperatur od 6 K do 110 K.

 $n_i^{-1}$  i nie osiąga zakresu zmian typu  $n_i^{-2}$  do temperatury 300 K włącznie, dla żadnego złącza z tej grupy złączy. Ilustruje to rys.41, na którym przedstawiono przykładowo zależność  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złączy B-2, C-2 i B-4.

Dla złączy grupy IV nie zmierzono charakterystyk C = f(U) ze względu na bardzo małą oporność różniczkową w 77 K za wyjątkiem złączy Z-11 i Z-13, które mają wyższą oporność różniczkową niż pozostałe złącza tej grupy. Dla tych złączy określono parametr t = 2.





83.



Rys.39. Zależność  $d^2U/dI^2 = f(U)$  dla złącza P-138 w T = 4.2 K.



Rys.40.  $R_0 A = f(\frac{10^3}{T})$  dla kilku zlączy grupy IV



Rys.41.  $R_0 A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złącza B-2, C-2 i B-4 w zakresie temperatur od ok. 70 K do 125 K

4.4. Analiza wyników eksperymentalnych.

W pracy badano złącza p-n  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te wykonane na bazie epitaksjalnych warstw  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te . W badanych złączach wartość  $\lambda_{C_0}(77)$  zmieniała się od ok. 1 µm do kilkunastu µm, co odpowiada zmianom  $\operatorname{E}_0$  od ok. 1,08 eV do 0,06 eV oraz składom molowym 0,19 < x < 0,80.

Krawędź efektu PV jest stosunkowo ostro rosnąca szczególnie dla mniejszych wartości  $\lambda_{\rm CO}(77)$  (patrz rys.15,21,35) a także sygnał fotoodpowiedzi rośnie wraz ze zmniejszaniem się wartości  $\lambda_{\rm CO}(77)$ .

Dla wszystkich badanych złączy w zakresie temperatur od 4.2 K do ok. 25 K zaobserwowano tzw. anomalię zerową. Za istnienie tej anomalii, odpowiedzialny jest efekt tunelowania rezonansowego [43]. Jakościowe porównanie charakterystyk oporności różniczkowej dU/dI w funkcji napięcia. U polaryzującego badane złącze, z wynikami obliczeń teoretycznych dU/dI = f(U) wykonanych w pracy [43] (rys.8 rozdz.3.6), pozwala przypuszczać, że defekty odpowiedzialne za efekt tunelowania rezonansowego umiejscowione są w obszarze ładunku przestrzennego, w pobliżu strony p , w odległości energetycznej  $E_{R_0}$  takiej, że  $0 \leq E_{R_0} \leq$  kilka meV powyżej poziomu Fermiego przy zerowej polaryzacji, np. dla złącza P-138, wartość  $E_{R_0} \cong 3$  meV (patrz strzałka na rys.38).

W T = 4.2 K, dla wielu złączy na charakterystykach dU/dI w funkcji napięcia U polaryzującego, pojawiają się osobliwości lepiej widoczne na charakterystykach  $d^2U/dI^2 = f(U)$ ) ale tylko dla polaryzacji w kierunku przewodzenia. Osobliwości

te znikają podobnie jak zerowa anomalia przy wzroście temperatury powyżej ok. 20 - 30 K . Związane są one z tunelowaniem rezonansowym z udziałem fononów (patrz rozdz.3.6). Położenie tych osobliwości pozwala określić wartość energii fononów podłużnych optycznych w Cd\_Hg<sub>1-x</sub>Te. Na rys.42 i 43 przedstawiono zależności  $d^2 U/dI^2 = f(U)$  w T = 4.2 K dla złączy P-182 (x = 0,2) i P-189 (x = 0,25). Strzałkami oznaczono osobliwości występujące przy  $U = (20 \pm 1)$  meV. Ponieważ dla tych złączy wartość  $E_{R_0}$  określona z charakterystyk dU/dI=f(U) wynosi ok. 2 meV, stąd zgodnie ze wzorem (63) wartość energii fononów podłużnych optycznych wynosi ok. (18 ± 1) meV. Natomiast wartość  $\hbar \omega$  LO określona z położenia osobliwości oznaczonej strzałką na rys.39 dla złącza P-138 (x = 0,27) wynosi ok. (19  $\pm$  1) meV (przy wartości  $E_{R_0} = 3$  meV). Otrzymane tak wartości  $\pm \omega$  LO są równe energii modu HgTe fononów LO w  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te [23] dla rozpatrywanych wartości składów x. Mod CdTe fononu LO dla badanych skladów powinien być wyraźnie słabszy i w związku z tym nie jest widoczny.

Występowanie osobliwości na charakterystykach  $d^2U/dI^2 = f(U)$  przy większej polaryzacji (osobliwości na rys. 39,42 i 43 nie oznaczone strzałką) może być związane z tunelowaniem rezonansowym z udziałem poziomów znajdujących się w obszarze przerwy energetycznej po stronie p złącza p-n.

Dla złączy grupy I, II i III, w temperaturze 77 K, z pomiarów charakterystyk pojemności C w funkcji napięcia U polaryzującego złącza wynika, że większość złączy ma skokowy profil domieszek (t = 2; patrz tabela I). Jedynie kilka złączy ma parametr t  $\neq$  2. Są to złącza: Z-6 (t = 2.6); 89



Rys. 42.  $d^2 U/dI^2 = f(U) dla złącza P-182 w T = 4.2 K do 11 K.$ 



Rys.43. 
$$d^2 U/dI^2 = f(U) dla złącza P-189 w T = 4.2 K$$

90 .

F-5 (t  $\approx$  1); oraz F-3 (t = 1.7). Określona na podstawie pomiarów C = f(U) w 77 K wartość e · U<sub>bi</sub> jest mniejsza lub równa w przybliżeniu wartości E<sub>0</sub> określonej z efektu PV, za wyjątkiem złączy grupy III, dla których e · U<sub>bi</sub> jest większe od E<sub>0</sub> (patrz tabela I). Związane to jest z degeneracją po jednej lub po obydwu stronach złącza p-n . Dla złącza obustronnie zdegenerowanego wysokość bariery e · U<sub>bi</sub> przy zerowej polaryzacji wyraża się [38] wzorem:

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{U}_{\mathbf{bi}} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}} + \mathbf{E}_{\mathbf{Fn}} + \mathbf{E}_{\mathbf{Fp}}$$
(71)

i  $U_{bi}$  jest większe od  $E_0$ , jeśli  $(E_{Fn} + E_{Fp})$  jest większe od zera. Istnienie degeneracji po obu stronach złącza p-n w złączach grupy III potwierdzają dodatkowo charakterystyki prądowo-napięciowe (patrz rys.29) na których w zakresie temperatur od 4.2 K do ok. 100 K obserwuje się przegięcie dla polaryzacji napięciem U w kierunku przewodzenia. Przegięcie to związane jest z tunelowaniem pasmo-pasmo możliwym tylko w przypadku gdy złącze p-n jest obustronnie zdegenerowane. Brak wyraźnego obszaru o ujemnej oporności w badanych złączach grupy III związany jest najprawdopodobniej z istnieniem dużego prądu nadmiarowego.

W temperaturach bliskich 4.2 K dla złączy grupy III i IV, wartość napięcia przy którym prąd gwałtownie rośnie (oporność różniczkowa maleje) przy polaryzacji napięciem w kierunku przewodzenia, jest zbliżona do wartości U<sub>bi</sub> (patrz rys.31 i 38). Natomiast dla złączy grupy I i II wartość ta jest większa od U<sub>bi</sub> i rośnie wraz ze zmniejszaniem się  $\lambda_{C_0}(77)$ (patrz rys.18 i 25). Należy zwrócić uwagę, że mierzony spadek napięcia jest sumą spadków napięć na samym złączu i na oporności szeregowej w skład której wchodzą oporności obszarów typu p i n, oraz oporności kontaktów. Można z tego wnioskować, że w złączach grupy III i IV oporność szeregowa jest do pominięcia w porównaniu do oporności złącza, natomiast w złączach grupy I i II oporność szeregowa jest porównywalna lub znacznie większa od oporności samego złącza. Związane jest to z faktem, że oporność obszaru typu p dla  $Cd_xHg_{1-x}Te$  z x > 0,3 rośnie w miarę wzrostu x i zmniejszającej się temperatury. Dlatego też niemożliwa jest analiza mechanizmów transportu przez złącza grupy I i II w tych temperaturach.

Należy zwrócić uwagę, że w złączach grupy III oporność szeregowa jest do pominięcia, mimo że odpowiadająca im wartość  $\lambda_{C_0}(77)$  mieści się w zakresie  $\lambda_{C_0}(77)$  dla grupy II, dla której to oporność szeregowa nie jest zaniedbywalna. Może to być związane z faktem, że warstwy epitaksjalne z których wykonano złącza grupy III mają wyższą koncentrację akceptorów N<sub>A</sub> niż złącza grupy II, o czym świadczą również wspomniane wcześniej przegięcia na charakterystykach prądowo-napięciowych związane z tunelowaniem pasmo-pasmo.

W temperaturach bliskich temperaturze pokojowej wszystkie zlącza mają zaniedbywalnie małą oporność szeregową w porównaniu do oporności samego złącza.

Dla wszystkich badanych złączy za wyjątkiem F-1 i Z-10 na charakterystykach  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  zaobeerwowano w różnych zakresach temperatur (ale zawsze większych od ok.80 K) zachowanie  $R_0A$  proporcjonalne do  $n_i^{-1}$  (patrz rys.19,26,33,41).

92

- 93 -

Świadczy to o dominacji prądu generacji-rekombinacji. W temperaturach bliskich temperaturze pokojowej dla złączy grupy III obserwuje się ponadto obszar w którym dominuje prąd dyfuzyjny. Świadczy o tym zachowanie się parametru  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  proporcjonalne do  $n_i^{-2}$  (patrz rys.33).

Na rys.44 przedstawiono zależność temperatury przy której parametr  $R_0 A = f(\frac{10^3}{T})$  zaczyna zachowywać się proporcjonalnie do  $n_i^{-1}$  w funkcji  $\lambda_{C_0}(77)$  dla wszystkich badanych złączy. Pionowymi kreskami zaznaczono błąd wyznaczenia tej temperatury zaś poziomymi błąd wyznaczenia wartości  $\lambda$  <sub>Co</sub>(77)z pomiarów efektu PV. Temperatura przy której prąd ciemny może być ograniczony prądem generacji-rekombinacji rośnie w miarę zmniejszania się wartości  $\lambda$  <sub>Co</sub>(77). Wiąże się to z faktem, że ze wzrostem  $\lambda_{CO}(77)$  maleje odpowiednio wartość przerwy energetycznej E<sub>0</sub> i prąd generacji-rekombinacji zaczyny dominować w niższej temperaturze. Żadne z badanych złączy, za wyjątkiem złącza D-1 nie jest ograniczone jako detektor PV prądem generacji-rekombinacji w temperaturze pracy, czyli w 77 K. Potwierdzają to również charakterystyki prądowo-napięciowe dla tych złączy, mierzone w 77 K, dla polaryzacji w kierunku przewodzenia. Otrzymane wartości współczynników nachylenia charakterystyk lnI = f(U) i ich nieznaczna zmiana z temperaturą, świadczyć mogą o dominacji prądu nadmiarowego, dla którego współczynnik nachylenia charakterystyk  $lnI_{z} = f(U)$  niewiele zmienia się w funkcji temperatury. Dla niektórych złączy współczynniki te nie zmieniają się z temperaturą w zakresie od 4.2 K do 77 K. Ilustruje to rys.45 na którym przedstawiono przykładową zależność  $\log I = f(U) dla złącza P-180$ W





Rys.45. Zależność log I = f(U) dla złącza P-180 w T = 4.2 K i T = 77 K

95 -

T = 4.2 K i 77 K. Współczynnik nachylenia charakterystyk ln I = f(U) wynosi w tym wypadku ok.  $20V^{-1}$  w obydwu temperaturach.

Gdyby dominował prąd dyfuzyjny, wówczas te współczymniki nachylenia byłyby znacznie większe i zmieniałyby się od około 2760 V<sup>-1</sup> w T = 4.2 K do 150 V<sup>-1</sup> w T = 77 K. Podobna sytuacja wystąpiłaby gdyby prądem dominującym był prąd generacji--rekombinacji. Wówczas współczynnik nachylenia powinien się zmieniać od 1380 V<sup>-1</sup> w T = 4.2 K do 75 V<sup>-1</sup> w T = 77 K. Występowanie dwóch obszarów prostoliniowych na zależnościach log I = f(U) (dla polaryzacji w kierunku przewodzenia) w niskich temperaturach w złączach grupy IV może być związane z prądem nadmiarowym (pierwszy zakres, dla  $eU < E_0$ ) i mieszanym mechanizmem: prądu generacji-rekombinacji i prądu nadmiarowego (drugi zakres, dla  $eU = E_0$ ).

Dla złączy grupy III i IV w zakresie temperatur od ok. 40 K do 80 K, na charakterystykach  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  obserwuje się minimum (patrz rys.32 i 40). Temperatura przy której występuje minimum odpowiada temperaturze przy której prąd płynący przez złącze spolaryzowane w kierunku zaporowym wykazuje maksimum, np. dla złącza D=6, minimum występuje w T  $\cong$  60 K (patrz rys.47 i krzywe 2,3 na rys.37).

Istnienie minimum na charakterystykaoh  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$ w złączach grupy III i IV wyjaśnić można tunelowaniem z udziałem poziomów akceptorowych.

Obliczono parametr (R<sub>O</sub>A)<sub>t</sub> związany z tunelowaniem z udziałem poziomów akceptorowych posługując się modelem przed- 97 .

stawionym w pracach [32, 38] dla złącza A-5 z grupy III oraz dla złączy: D-6, A-3 i B-4 z grupy IV.

Złącze A-5 jest złączem o skokowym profilu domieszek (t = 2). Dla takiego złącza, szerokość  $W_0$  złącza przy zerowej polaryzacji wyraża się wzorem (68) w którym podstawiono U = 0. Obliczając natężenie pola elektrycznego w obszarze ładunku przestrzennego przy zerowej polaryzacji  $F_0$ =  $= U_{bi}/W_0$  i podstawiając tą wartość  $F_0$  do wzoru (54) otrzymano następującą zależność na parametr  $(R_0A)_t$  związany z tunelowaniem z udziałem poziomów akceptorowych dla złącza o skokowym profilu domieszek:

$$(R_0 \dot{A})_t = 2,36 \left( \frac{m_e^*}{m_0} \right)^{-1} \cdot 10^4 \cdot Z \cdot \exp(2,1 \cdot 10^{13} \cdot E_0 \cdot Z) \cdot \frac{N_v}{P_0} \left( 1 + \frac{1,85 \cdot 10^{-14}}{Z \cdot k \cdot T} \right) \left[ \Omega \text{ cm}^2 \right]$$
(72)

gdzie

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{m}{e} & E_{0} & \xi_{s} \\ \hline & N_{B} & U_{bi} \end{bmatrix}^{1/2}$$
(73)

i  $E_0$  wyraża się w [eV],  $N_B$  w  $[m^{-3}]$ ,  $U_{bi}$  w [V] i k · T w [eV].

Do obliczenia  $R_0A$  wartość  $E_0(T)$  dla zadanej wartości x obliczono ze wzoru (4) natomiast  $m_e^*(T)$  obliczono z zależności (3), przyjmując wartość pędowego elementu macierzowego w modelu Kane'a  $\begin{bmatrix} 54 \end{bmatrix}$ ,  $P = 8,4 \cdot 10^{-10} [eV/m]$ . Wartość rozszczepienia  $\triangle$  wynikającego z oddziaływania spin-orbita, 98 **-**

obliczono przyjmując liniową zmianę  $\triangle$  od składu, od wartości 0,9 [eV] dla CdTe do 1.1 [eV] dla HgTe [55].

Wartość  $\xi_s$  obliczono z następującej [56] zaleźności:

$$\xi = 20, 5 - 13, 75 \cdot x$$
 (x < 0, 45) (74)

Wartość U<sub>bi</sub> w 77 K przyjęto z pomiarów C = f(U). W celu określenia wysokości bariery U<sub>bi</sub> dla temperatur różnych od 77 K , skorzystano ze wzoru (71). Z pomiarów efektu Halla określono koncentrację N<sub>A</sub>. Ponieważ znany był tylko przedział wartości  $N_{\Lambda}$  a nie znana była jej dokładna wartość, przyjęto N<sub>A</sub> jako parametr dopasowania. Wartość  $E_{Fp}(T)$  zależy od  $N_A$  oraz od wartości energii poziomu akceptorowego E<sub>A</sub>, którą również przyjęto jako parametr dopasowania. W obliczeniach przyjęto współczynnik degeneracji g = 4 25 . Wartość E<sub>Fn</sub> w 77 K obliczono ze wzoru (71). Stąd, zakladając że w T = 77 K wszystkie donory są zjonizowane, określono wartość  $N_{\rm D}$ . Pozwoliło to na wyznaczenie wartości  $N_{\rm B}$ . Następnie zakladając całkowitą jonizację donorów w całym zakresie temperatur w którym robione było dopasowanie, policzono zależność  $E_{Fn}(T)$ . Znajomość zależności  $E_0(T)$  pozwoliła wyznaczyć zależność  $U_{bi}(T)$  .  $N_{v}(T)$  obliczono korzystając ze wzoru (53) natomiast P<sub>O</sub>(T) obliczono korzystając z obliczonych uprzednio zależności  $E_{Fp}(T)$  i  $N_v(T)$ .

Obliczony w ten sposób parametr  $(R_0^A)_t$  związany z mechanizmem tunelowania z udziałem poziomów akceptorowych daje dopasowanie do eksperymentalnych wartości  $R_0^A$  jedynie w wąskim obszarze temperatur w pobliżu minimum. W niskich temperaturach, poza obszarem minimum wartości teoretyczne  $(R_0A)_t = f(\frac{10^3}{T})$ znacznie przewyższają wartości eksperymentalne. Dlatego też w dopasowaniu uwzględniono również prąd związany z tunelowa niem rezonansowym, który jak pokazano wcześniej, dominuje w pobliżu temperatur helowych. Parametr  $R_0A_r$  związany z tym prądem powinien nieznacznie maleć ze wzrostem temperatury (patrz wzór (65)). W dopasowaniu przyjęto dla uproszczenia, że parametr  $R_0A_r$  związany z prądem tunelowym rezonansowym jest stały i równy zmierzonej w T = 4.2 K wartości  $R_0A_r$ 

Na rys.46 przedstawiono teoretyczną (linia ciągła) i eksperymentalną zależność  $R_0A = f(\frac{10^3}{T})$  dla złącza A-5 z grupy III. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla  $E_A = 0,004$  eV,  $N_A = 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$  przy  $N_D = 2 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ .

Analogiczne dopasowanie parametru  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  do danych eksperymentalnych wykonano również dla zlączy: D-6; B-4 i A-3, z grupy IV. Złącza te zostały wykonane tą samą metodą co złącza pozostałych grup, z których większość ma skokowy profil domieszek. Dlatego też założono dla celów tego dopasowania, że złącza grupy IV mają również skokowy rozkład domieszek. Założenie to pozwoliło skorzystać ze wzoru (72) na obliczenie parametru ( $R_0^A$ )<sub>t</sub> związanego z tunelowaniem z udziałem poziomów akceptorowych. Wartości U<sub>bi</sub>(T) określono tak jak poprzednio ze wzoru (71) ale w tym przypadku parametrami dopasowania oprócz  $E_A$  i  $N_A$  była również koncentracja  $N_D$ . Wyniki dopasowania dla złączy D-6, B-4 i A-3 przedstawiono na rys.47 - 49. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla  $E_A \cong 0.02$  eV i  $N_D = 2 \div 5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ , przy  $N_A = 7 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ .



Rys.46. Zależności  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$ : teoretyczna (linia ciągła) i eksperymentalna, dla złącza A-5.



Rys.47. Zależności  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$ : teoretyczna (linia ciągła) i eksperymentalna, dla złącza D-6.



ciągła) i eksperymentalna, dla złącza B-4.



- 104 -

Większa wartość  $E_A$  dla złączy grupy IV w porównaniu z wartością  $E_A$  dla złącza A-5 z grupy III może być związana z niższą wartością  $N_A$  w złączach grupy IV. Pozostaje to w zgodności z wcześniejszymi hipotezami, że w złączach grupy III koncentracja  $N_A$  jest wyższa niż w pozostałych złączach. Otrzymane wartości parametrów  $E_A$  i  $N_A$  przy których uzyskano najlepsze dopasowanie pozostają w zgodności z cytowanymi w literaturze [25] (patrz rozdz.2).

Na rys.50 przedstawiono zależność parametru  $R_0A$  w 77 K w funkcji długości fali  $\lambda_{C_0}(77)$  dla wszystkich badanych złączy oraz dla badanych w pracy [57,58] złączy p-n Cd\_Hg\_\_\_Te wykonanych metodą implantacji jonów. Na rys.50 kreskami pionowymi oznaczono bląd pomiaru R<sub>O</sub>A natomiast poziomymi błąd  $\Delta \lambda_{C_0}$  (77). Wartość R<sub>0</sub>A maleje w funkcji  $\lambda_{C_0}(77)$ , podobnie jak w wypadku złączy badanych w [57,58], natomiast wartości parametru R<sub>0</sub>A otrzymane w niniejszej pracy są mniejsze niż otrzymane w 57,58 i porównywalne z wartościami otrzymanymi w [59], gdzie badano złącza p-n Cd Hg Te wykonane również metodą wygrzewania materiału typu p w parach rtęci. Na rys.50 zaznaczono również parametr R<sub>O</sub>A dla złączy serii Z badanych w niniejszej pracy, wygrzewanych najdłużej (5 h). Parametr ROA dla tych złączy jest większy niż w przypadku innych złączy o podobnym skladzie molowym x badanych w niniejszej pracy.



106 -

## 5. PODSUMOWANIE

Podstawowym celem pracy było zbadanie zjawisk transportu prądu w złączach p-n wykonanych na bazie warstw epitaksjalnych Cd\_Hg\_1-x Te w zakresie składów molowych 0,19 < x < 0.8.

Badane złącza podzielono na cztery grupy. Kryterium podziału stanowiła graniczna długość fali zjawiska fotowoltaicznego  $\lambda$  C<sub>0</sub> w 77 K, czyli szerokość przerwy energetycznej E<sub>0</sub> lub inaczej skład molowy w obszarze złącza p-n . W obrębie każdej grupy, złącza charakteryzowały się podobnymi charakterystykami efektu PV w 77 K, prądowo-napięciowymi oraz zależnościami oporności różniczkowej od temperatury, w zakresie temperatur od 4.2 K do 300 K.

Stwierdzono, że większość złączy dla których zmierzono charakterystyki C = f(U) w 77 K, a więc złączy grupy I, II, i III, ma skokowy profil domieszek (t = 2) i charakteryzuje się tym, że wysokość bariery e  $\cdot$  U<sub>bi</sub> w 77 K jest mniejsza lub równa w przybliżeniu wartości przerwy energetycznej E<sub>0</sub>, za wyjątkiem złączy grupy III, dla których e  $\cdot$  U<sub>bi</sub>(77)  $\geq$ E<sub>0</sub>(77).

Stwierdzono także, że w nieoświetlonych złączach p-n:
w zakresie temperatur od 4.2 K do 77 K dla większości złączy spolaryzowanych napięciem w kierunku przewodzenia dominującym mechanizmem transportu prądu jest prąd nadmiarowy,
w złączach grupy I i II w zakresie temperatur od 4.2 do

80 K oporność obszaru typu p jest porównywalna z opornością samego złącza, przy polaryzacji napięciem w kierunku przewodzenia,

- w zakresie temperatur od ok. 200 K do 300 K w złączach grupy I, II i IV, przy polaryzacji bliskiej zeru dominuje prąd generacji-rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego lub w warstwie przypowierzchniowej,
- w złączach grupy III w których koncentracja akceptorów jest większa niż w przypadku wszystkich pozostałych złączy,
  w T > 200 K przy polaryzacji bliskiej zeru dominuje prąd generacji-rekombinacji a w pobliżu temperatury pokojowej dominuje prąd dyfuzyjny,
- w zakresie temperatur od ok.40 do 80 K w złączach grupy III ( $\lambda_{C_0}(77) \cong 4 \ \mu\text{m}$ ) i grupy IV ( $\lambda_{C_0}(77) > 6 \ \mu\text{m}$ ), w pobliżu zerowej polaryzacji dominuje prąd tunelowy z udziałem poziomów akceptorowych,
- w zakresie temperatur od 4.2 K do ok. 25 K we wszystkich złączach dominuje tunelowy prąd rezonansowy przy polaryzacji bliskiej zeru.

W zakresie temperatur od 4.2 K do 100 K dla kilku zlączy z grupy III i JV przeprowadzono dopasowanie parametru  $R_0^A = f(\frac{10^3}{T})$  do wyników eksperymentalnych biorąc pod uwagę mechanizm tunelowania z udziałem poziomów akceptorowych i tunelowania rezonansowego, zakładając skokowy profil domieszek. Parametrami dopasowania były:  $N_A$ ,  $N_D$  i  $E_A$ . Najlepsze dopasowanie ilościowe i jakościowe otrzymano dla  $E_A = 0,004$  eV i  $N_A = 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$  przy  $N_D = 2 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$  dla zlącza A-5 z grupy III. Dla zlączy B-4, D-6 i A-3 z grupy IV najlepsze dopasowanie ilościowe i jakościowe otrzymano dla  $E_A = 0,02$  eV i  $N_{\rm D} = 2 \div 5 \cdot 10^{22} {\rm m}^{-3}$ , przy  $N_{\rm A} = 7 \cdot 10^{22} {\rm m}^{-3}$ . Uzyskane wartości  $E_{\rm A} = 0.004 {\rm eV}$  przy  $N_{\rm A}$ :  $1 \cdot 10^{23} {\rm m}^{-3}$  i  $E_{\rm A} = 0.02 {\rm eV}$ przy  $N_{\rm A} = 7 \cdot 10^{22} {\rm m}^{-3}$  są zgodne z cytowanymi w literaturze [24, 25, 26].

Dodatkowo z pomiarów dU/dI = f(U) i  $d^2U/dI^2 = f(U)$ w T = 4.2 K określono wartość energii fononów podłużnych optycznych modu HgTe w niektórych złączach (dla których x  $\ge$  0,2), równą  $\hbar\omega_{L0} = (18 \pm 1)$  meV.

Stwierdzono ponadto, że:

- fotoodpowiedź oświetlonych złączy p-n  $\operatorname{Cd}_{\mathbf{x}}\operatorname{Hg}_{1-\mathbf{x}}$ Te w 77 K maleje ze zmniejszaniem się składu molowego **x**, co jest związane z faktem, że parametr R<sub>0</sub>A(77) również maleje ze zmniejszaniem się **x**. Wiąże się to z rosnącym udziałem prądu tunelowego ze zmniejszaniem się **x**,
- krawędź efektu PV jest tym ostrzejsza im większa jest wartość składu molowego x ,
- dla złączy serii Z, wygrzewanych najdłużej (5 h) parametr R<sub>0</sub>A a zatem i sygnał fotoodpowiedzi jest większy niż w przypadku innych złączy o podobnym składzie x. Może to być związane z faktem, że dłuższe wygrzewanie ujednoradnia warstwę, poprawiając jej parametry,

- wartości parametru  $R_0^A(77 \text{ K})$  badanych złączy są porównywalne z wartością parametru  $R_0^A(77)$  dla złączy p-n  $Cd_xHg_{1-x}Te$  otrzymanych metodą wygrzewania materiału typu p [59]. Świadczy to o.tym, że metoda otrzymywania złączy na podłożu z warstwą epitaksjalną jest metodą za pomocą której otrzymuje się dobre złącza p-n. Należy podkreślić,
że metoda ta jest bardzo wygodna, ponieważ można otrzymać detektor PV na żądany zakres długości fal dobierając odpowiednią grubość warstwy epitaksjalnej.

- 110 -
- 6. LITERATURA
- 1 P.Becla, Praca doktorska, Inst.Fizyki Pol.Wrocł., (1977), niepublikowana.
- 2 J.M.Pawlikowski, "Electrical and photoelectric properties of gradeg-gap epitaxial  $\operatorname{Cd}_{x}\operatorname{Hg}_{1-x}$  Te layer". Prace naukowe Instytutu Fizyki PWr. <u>12</u>, no.4 (1978).
- 3 patrz np. J.M.Pawlikowski, P.Becla, Infrared Phys. <u>15</u>, 331 (1975); P.Becla, J.M.Pawlikowski, Infrared Phys. <u>16</u>, 457 (1976); J.M.Pawlikowski, Thin Solid Films, <u>44</u>, 241 (1977).
- 4 E.Placzek-Popko, Materials Science, 5, 59 (1979).
- 5 P.Becla, E.Placzek-Popko, Infr. Phys. 21, 323 (1981).
- 6 E.Płaczek-Popko, Proceedings. XI School on Phys. of semicond. Comp., Jaszowiec 1981, wyd.Zakł.Nar.Ossol. vol.<u>93</u>, (1982).
- 7 E.Płaczek-Popko, Proc.XIII School on Phys.of Semicond. Comp., Jaszowiec 1984, Acta Phys.Pol. <u>A67</u>, 237 (1985).
- 8 E.Płaczek-Popko, J.M.Pawlikowski, IEEE Trans.Electron. Devices ED-35, (1985).
- 9 E.Płaczek-Popko, J.M.Pawlikowski, Proc.Internal.Conf. Compensated Semiconductors, Madras, February (1985), w druku.
- 10 E.Płaczek-Popko, J.M.Pawlikowski, Proc.Internat.Conf. on II-VI Semicond. Compounds, Aussois, March 1985, Journal of Crystal Growth, w druku.
- 11 E.Płaczek-Popko, Proc.XIV School on Phys.of Semicond. Comp., Jaszowiec 1985, Acta Physica Polonica, w druku.
- 12 E. Płaczek-Popko, J.M. Pawlikowski, "R A product in

 $Cd_x Hg_{1-x}$  Te detectors", Proc. 3rd Internat.Workshop on Semiconductor Devices Madras, December (1985) w druku.

- 13 R.H. Parmenter, Phys. Rev. <u>134</u>, A226 (1964).
- 14 J.M. Pawlikowski, Thin Solid Films 44, 241 (1977).
- 15 E.O.Kane, J.Phys.Chem.Solids, 1, 294 (1957).
- 16 E.O.Kane, "Phys, of III-V compounds", vol.1, wyd. R.K.Willardson, A.C.Beer, Academic Press N.J. (1966).
- 17 J.D. Wiley, R.N. Dexter, Phys. Rev. 181, 1181 (1969).
- 18 J.L.Schmit, E.L.Stelzer, J.Appl. Phys. 40, 4865 (1969).

19 M.W.Scott, J.Appl. Phys. <u>40</u>, 4077 (1969).

- 20 J.Blinowski, L.Leibler, Phys. of Narrow Gap Semicond., Warsaw, Poland, 12-15 Sept. 1977, ed. Amsterdam, Netherlands (1978).
- 21 K.Sierański, J.Szatkowski, J.M.Pawlikowski, E.Majchrowska, E.Płaczek-Popko, Phys.Stat.Solidi (b) <u>81</u>, K67 (1977).
- 22 J.L.Schmit, J.Appl. Phys. 41, 2876 (1970).
- 23 R.Dornhaus, G.Nimtz, Solid St.Physics. wyd.Springer Verlag (1976).
- 24 C.T.Elliott, J.Melngailis, R.C.Harman, A.G.Foyt, J.Phys.Chem.Solids, <u>33</u>, 1527 (1972).
- 25 W.Scott, E.L.Stelzer, R.J.Hager, J.Appl. Phys. <u>47</u>, 1403 (1976).
- 26 M.A.Kinch, J.Vac.Sci.Technology 21, 215 (1982).
- 27 D.L.Polla, C.E. Jones, J.Appl. Phys. <u>52</u>, 5118 (1981).
- 28 R. Dorhhaus, H. Happ, K. H. Muller, G. Nimtz, W. Schlabitz,

P.Zapliński, G.Bauer, "Proc.XII-th Int.Conf.Phys. Semicond.", Stuttgart (1974), wyd. M.H.Pilkuhn.

- 29 P.Becla, J.Lagowski, H.C.Gatos, L.Jędral, J.Electrochem. Soc. <u>129</u>, 2855 (1982).
- 30 A.A.A.Hady, praca doktorska, Inst.Fizyki Polit.Wrocl, (1984), nie publikowana.
- 31 S.M.Sze, "Phys.of Semicond.Devices", wyd. J.Wiley Sons N.J. (1969).
- 32 M.B.Reine, A.K.Sood, T.J.Tredwell, "Semiconductors and Semimetals" vol. 18, wyd.R.K.Willardson, A.C.Beer, Academic Press, N.J. (1981).
- 33 D.L.Polla, S.P.Tobin, M.B.Reine, A.K.Sood, J.Appl.Phys. 52, 5182 (1981).
- 34 W.Shockley, W.T.Read, Jr. Phys.Rev. 87, 835 (1952).
- 35 T.N.Casselman, P.E.Petersen, Solid St. Communic <u>33</u>, 615 (1980).
- 36 C.T.Sah, R.N.Noyce, W.Shockley, Proc. IRE 45, 1228 (1957).
- 37 C.B.Duke, "Tunneling in solids," Solid St. Phys., wyd. F.Seitz, D.Turnball, H.Ehrenreich Academic Press London England (1969).
- 38 E.O.Kane, J.Appl. Phys. <u>32</u>, 83 (1961).
- 39 R.R.Gałązka, T.Zakrzewski, Phys.Stat.Solidi 23, K39 (1967).
- 40 I.Y.Wong, IEEE Trans. Electron Devices, ED-27, 48 (1980).
- 41 A.G. Chynoweth, W.L.Feldman, R.L.Logan, Phys.Rev.<u>121</u>, 684 (1961).

 42 E.L.Wolf, "Nonsuperconducting Electron Tunneling Spectroscopy", Solid St.Physics wyd.F.Seitz, D.Turnball, H.Ehrenreich Academic Press, London, England (1975).

- 113 -
- 43 A.M.Andrews, H.W.Korb, N.Holonyak, Jr., C.B.Duke,
   G.G.Kleiman, Phys.Rev.B <u>5</u>, 2273 (1972).
- 44 R.N.Hall, Proc.Int.Conf.Semicond.Phys. Praga 1960, wyd.Academic Press, N.J. (1961).
- 45 R.N.Hall, J.H.Racette, H.Ehrenreich, Phys.Rev.Lett.<u>4</u>, 456 (1960).
- 46 H.W.Korb, A.M.Andrews, N.Holonyak, Jr., R.D. Burnham,
  C.B.Duke, G.G.Kleiman, Solid St.Communic.<u>9</u>, 153 (1971).
- M.J.Ludowise, N.Holonyak, Jr., P.D.Wright, B.A.Vojak,
   E.A.Rezek, H.W.Korb, J.Appl. Phys. <u>48</u>, 4287 (1977).
- M.J.Ludowise, E.A.Rezek, H.Shichijo, P.D.Wright,
   N.Holonyak, Jr., H.W.Korb, Appl. Phys.Lett. <u>30</u>,604 (1977).
- 49 G.G.Kleiman, praca doktorska, nieopublikowana.
- 50 P.Becla, J.Lagowski, H.C.Gatos, H.Ruda, J.Electrochem. Soc.128, 1171 (1981).
- 51 W.F.H.Micklethwaite, w [32].
- 52 P.Becla, dane niepublikowane.
- 53 J.G.Adler, J.E. Jackson, Rev. Sci. Instrum. 37, 1049 (1966).
- 54 J.Stankiewicz, W.Giriat, Sci. Pap. ITE, 2, 131 (1957).
- 55 M. Cardona, D. L. Greenaway, Phys. Rew. 125, 1291 (1962).
- 56 J.Baars, F.Sorger, Solid St.Commun.10, 875 (1962).
- A.K.Sood, T.J.Tredwell, 8-14 Micrometer Photovoltaic
   Detectors, Final Rep., U.S.Army Night Vision and Electro -Optics Laboratory Contract DAAK 70-76-C-0237 (DDC AB
   B037083L) (1978).
- 58 A.K.Sood, T.J.Tredwell, IEEE Int.Electron Device Meeting Techn.Digest 434 (1978).

59 I.F.Shanley, L.C.Perry, Infrared Heterodyne Photodiode Development and Characterization, Final Rep.Ballistic Missile Defense Advansed Technology Center Contract D ASG 60-77-C-0081 (DDC AD B033680 L) (1978).